

サーバの保守

この章は、次の項で構成されています。

- ステータス LED およびボタン (1 ページ)
- コンポーネント取り付けの準備(7ページ)
- ・サービス可能なコンポーネントの場所 (12ページ)
- ・主要シャーシ内でコンポーネントの交換 (19ページ)
- CPU モジュール内のコンポーネントの交換 (76 ページ)
- I/O モジュール内のコンポーネントの交換 (103 ページ)
- サービス DIP スイッチ (114 ページ)

ステータス LED およびボタン

ここでは、LED の状態の解釈について説明します。

前面パネルの LED

図 **1**:前面パネル LED



表 1:前面パネル LED、状態の定義

	LED 名	状態
1	電源ボタン/LED	 ・消灯:サーバにAC電力が供給されていません。
		 オレンジ:サーバはスタンバイ電源モードです。 Cisco IMC と一部のマザーボード機構にだけ電 源が投入されています。
		 ・緑:サーバは主電源モードです。すべてのサー バコンポーネントに電力が供給されています。
2	ユニット識別	・ 消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
		 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。
3	システム ヘルス	 ・緑:サーバは正常動作状態で稼働しています。
		 オレンジの点灯:サーバは縮退運転状態にあり ます(軽度の障害)。次に例を示します。
		・電源装置の冗長性が失われている。
		• CPU が一致しない。
		 ・少なくとも1つのCPUに障害が発生している。
		・少なくとも1つの DIMM に障害が発生して いる。
		 RAID 構成内の少なくとも1台のドライブ に障害が発生している。
		 オレンジの点滅:サーバは重大な障害発生状態 にあります。次に例を示します。
		・ブートの失敗
		 修復不能なプロセッサーまたはバスエラー が検出されました
		• 過熱状態

I

4	電源装置ステータス	 ・緑:すべての電源装置が正常に動作中です。
		 オレンジの点灯:1台以上の電源装置が縮退運 転状態にあります。
		 オレンジの点滅:1台以上の電源装置が重大な 障害発生状態にあります。
5	ファン ステータス	 ・緑:すべてのファンモジュールが正常に動作中です。
		 オレンジの点灯:ファンモジュールが低下状態です。1つのファンモジュールに障害があります。
		•オレンジの点滅:2つ以上のファンモジュール に障害があります。
6	ネットワーク リンク アクティビティ	 ・消灯:イーサネット LOM ポート リンクがアイ ドル状態です。
		 ・緑:1つ以上のイーサネットLOMポートでリン クがアクティブになっていますが、アクティビ ティは存在しません。
		•緑の点滅:1つ以上のイーサネットLOM ポート でリンクがアクティブになっていて、アクティ ビティが存在します。
7	温度ステータス	 ・緑:サーバは正常温度で稼働中です。エラーが 検出されませんでした。
		 オレンジの点灯:1つ以上の温度センサーが警告しきい値を超過しています。
		 オレンジの点滅:1つ以上の温度センサーで重要な回復不能なしきい値を超えました。
8	SAS/SATA ドライブの障害	・消灯:ハードドライブは正常に動作中です。
SAS	 (注) NVMe ソリッドステート ドライブ (SSD) ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な 	 ・オレンジ:ドライブ障害が検出されました。 ・オレンジの点滅:デバイスの再構成中です。
	ります。	•1 秒間隔のオレンジの点滅:ソフトウェアでド ライブ位置特定機能がアクティブ化されました。

9 SAS	SAS/SATA ドライブ アクティビティ LED	 消灯:ハードドライブトレイにハードドライブが存在しません(アクセスなし、障害なし)。
		 ・緑:ハードドライブの準備が完了しています。
		 ・緑の点滅:ハードドライブはデータの読み取り 中または書き込み中です。
8 NVMe	NVMe SSD ドライブ障害 (注) NVMe ソリッド ステート ドライブ	 ・消灯:ドライブが使用されていないため、安全 に取り外すことができます。
	(SSD)ドライブ トレイの LED の動作 は、SAS/SATA ドライブ トレイとは異な	 ・緑色:ドライブは使用中で、正常に機能しています。
	9 £ 9 。	 緑の点滅:ドライバがインサーションに続いて 初期化を実行中であるか、またはイジェクトコ マンドに従ってアンロードを実行中です。
		 オレンジ:ドライブに障害が発生しています。
		•オレンジの点滅:ドライブはソフトウェアで Locate コマンドを発行されました。
9	NVMe SSD アクティビティ	 消灯:ドライブアクティビティはありません。
NVMe		•緑の点滅:ドライブ アクティビティがありま す。
10	CPU モジュール電源の状態	•緑色:CPUモジュールが正常に取り付けられ、 電力を受信しました。
		 オフ: CPUモジュールの電源がないか、正しく 接続されていません。
11	CPUモジュール障害	•オフ: CPU モジュール ボードの CPU または DIMM に障害はありません。
		 オレンジ色: CPUモジュールボードに温度条件 などの CPU または DIMM の障害があります。
-	DVD ドライブ アクティビティ	 ・消灯:ドライブがアイドルです。
	(オプションのDVDモジュールは示されていませ ん)	 ・緑の点灯:ドライブでディスクがスピンアップ 中です。
		 緑の点滅:ドライブはデータにアクセス中です。

背面パネルの LED

図 **2**:背面パネル *LED*



表 2:背面パネル LED、状態の定義

	LED 名	状態
1	1 Gb/10 Gb イーサネット リンク速度(LAN1 と LAN2 の両方) これらのポートは、リンクパートナー機能に基づ いてリンク速度を自動調整します。	 ・消灯:リンク速度は 100 Mbps です。 ・オレンジ:リンク速度は 1 Gbps です。 ・緑:リンク速度は 10 Gbps です。
2	1 Gb/10 Gb イーサネットリンクステータス(LAN1 と LAN2 の両方)	 ・消灯:リンクが確立されていません。 ・緑:リンクはアクティブです。 ・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。
3	1 Gb イーサネット専用管理リンク速度	 ・消灯:リンク速度は 10 Mbps です。 ・オレンジ:リンク速度は 100 Mbps です。 ・緑:リンク速度は 1 Gbps です。
4	1 Gb イーサネット専用管理リンク ステータス	 ・消灯:リンクが確立されていません。 ・緑:リンクはアクティブです。 ・緑の点滅:アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

5	背面ユニット識別	・消灯:ユニット識別機能は使用されていません。
		 ・青の点滅:ユニット識別機能がアクティブです。
6	電源の状態(各電源装置に1つ)	AC 電源装置:
		 ・消灯:AC入力なし(12V主電源はオフ、12V スタンバイは電源オフ)です。
		•緑の点滅:12V主電源はオフ、12Vスタンバイ 電源はオンです。
		•緑の点灯:12V主電源はオン、12Vスタンバイ 電源はオンです。
		 オレンジの点滅:警告しきい値が検出されましたが、12V主電源はオンです。
		 オレンジの点灯:重大なエラーが検出されました(過電流、過電圧、過熱障害など)。12V主 電源はオフです。

内部診断 LED

システムでは、以下の内部障害 LED が備えられており、障害が発生したコンポーネントの特定に役立ちます。

- 各シャーシファンモジュールでは、モジュール上に障害 LED があります。これらのファンLED は、システムがスタンバイ電源モードの場合にのみ動作します。
- CPU モジュールには、CPU モジュールボードのCPU と DIMM に内部障害 LED を備えて います。POST およびランタイムのエラー検出ルーチンはオンボードレジスタに保存され ます。登録内容は、supercap 電圧源に期間限定で保持されます。

LED を動作するには、CPU がシャーシから削除された後、CPU モジュール ボードのス イッチ SW1 を押します。 図 3: 内部診断 LED の場所



1	CPU 障害 LED(ボード上の各 CPU ソケット の後方に 1 つ)	3	DIMM 障害 LED(ボード上の各 DIMM ソケッ トの隣に 1 つ)
	•オレンジ: CPU に障害が発生していま す。		• オレンジ : DIMM に障害が発生していま す。
	 消灯: CPU は正常です。 		 消灯: DIMM は正常です。
2	スイッチ SW1	-	
	SW1は「ここを押して障害を確認する」とラ ベリングされています。		

コンポーネント取り付けの準備

ここでは、サーバへのコンポーネントの取り付けの準備に役立つ情報およびタスクについて説 明します。

サービス手順に必要な工具

この章の手順を実行するには、次の工具および器具を使用します。

- T-30 トルクス ドライバ (ヒートシンクの取り外し用、交換用 CPU に付属)
- No.1 マイナス ドライバ (ヒートシンクの取り外し用、交換用 CPU に付属)
- •No.1 プラス ドライバ (M.2 SSD の交換用)
- •静電気防止用(ESD)ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

サーバのシャットダウンと電源切断

サーバは次の2つの電源モードのいずれかで動作します。

- ・主電源モード: すべてのサーバコンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティングシステムが動作できます。
- スタンバイ電源モード:電力はサービスプロセッサと特定のコンポーネントにのみ供給されます。このモードでサーバから電源コードを外すことにより、オペレーティングシステムおよびデータの安全を確保します。

/!\

注意 サーバがシャットダウンされてスタンバイ電源になった後も、電流は引き続きサーバ上に残っ ています。電源を完全に切断するには、サービス手順の指示どおりに、サーバ内の電源装置か らすべての電源コードを取り外す必要があります。

サーバをシャットダウンするには、前面パネルの電源ボタンまたはソフトウェア管理インター フェイスを使用します。

電源ボタンを使用したシャットダウン

- ステップ1 電源ボタン/LED の色を確認します。
 - オレンジ:サーバはスタンバイモードであり、安全に電源を切断することができます。
 - ・緑:サーバは主電源モードであり、安全に電源を切断するにはシャットダウンする必要があります。
- **ステップ2**次の手順でグレースフルシャットダウンまたはハードシャットダウンを実行します。
 - 注意 データの損失やオペレーティング システムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペレーティング システムのグレースフル シャットダウンを実行するようにしてください。
 - ・グレースフルシャットダウン:電源ボタンを押して放します。オペレーティングシステムでグレース フルシャットダウンが実行され、サーバはスタンバイモードに移行します。移行すると、電源ボタン/LED がオレンジで示されます。

- •緊急時シャットダウン:4秒間電源ボタンを押したままにして主電源モードを強制終了し、スタンバイモードを開始します。
- **ステップ3** サービス手順でサーバの電源を完全に切断するよう指示されている場合は、サーバの電源装置からすべての電源コードを外します。

Cisco IMC GUI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

- ステップ1 [Navigation] ペインの [Server] タブをクリックします。
- ステップ2 [Server] タブの [Summary] をクリックします。
- ステップ3 [Actions] 領域で、[Power Off Server] をクリックします。
- ステップ4 [OK] をクリックします。

オペレーティング システムでグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モードに移 行します。移行すると、電源ボタン/LED がオレンジで示されます。

ステップ5 サービス手順でサーバの電源を完全に切断するよう指示されている場合は、サーバの電源装置からすべての電源コードを外します。

Cisco IMC CLI を使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

ステップ1 サーバプロンプトで、次のように入力します。

例:

server# scope chassis

ステップ2 シャーシプロンプトで、次のように入力します。

例:

server/chassis# power shutdown

オペレーティング システムでグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モードに移 行します。移行すると、電源ボタン/LED がオレンジで示されます。

ステップ3 サービス手順でサーバの電源を完全に切断するよう指示されている場合は、サーバの電源装置からすべての電源コードを外します。

Cisco UCS Manager の [Equipment] タブを使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

- ステップ1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
- ステップ2 [Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。
- ステップ3 シャットダウンするサーバを選択します。
- ステップ4 [Work] ペインの [General] タブをクリックします。
- ステップ5 [Actions] 領域で、[Shutdown Server] をクリックします。
- ステップ6 確認ダイアログが表示されたら、[Yes] をクリックします。

オペレーティング システムでグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モードに移 行します。移行すると、電源ボタン/LED がオレンジで示されます。

ステップ7 サービス手順でサーバの電源を完全に切断するよう指示されている場合は、サーバの電源装置からすべての電源コードを外します。

Cisco UCS Manager のサービス プロファイルを使用したシャットダウン

このタスクを実行するには、user または admin 権限を持つユーザとしてログインする必要があります。

- ステップ1 [Navigation] ペインで [Servers] をクリックします。
- ステップ2 [Servers] > [Service Profiles] を展開します。
- **ステップ3**シャットダウン対象のサーバのサービスプロファイルが含まれる組織のノードを展開します。
- **ステップ4** シャットダウンするサーバのサービス プロファイルを選択します。
- ステップ5 [Work] ペインの [General] タブをクリックします。
- ステップ6 [Actions] 領域で、[Shutdown Server] をクリックします。
- ステップ1 確認ダイアログが表示されたら、[Yes] をクリックします。

オペレーティング システムでグレースフル シャットダウンが実行され、サーバはスタンバイ モードに移 行します。移行すると、電源ボタン/LED がオレンジで示されます。

ステップ8 サービス手順でサーバの電源を完全に切断するよう指示されている場合は、サーバの電源装置からすべての電源コードを外します。

サーバ上部カバーの取り外し

ステップ1 次のようにして、上部カバーを取り外します。

- a) カバーのラッチがロックされている場合は、ドライバを使用して、ロックを反時計回りに90度回転させて、ロックを解除します。
- b) 緑のつまみがあるラッチの終端を持ち上げます。ラッチを持ち上げながら、カバーを開いた位置に押 し戻します。
- c) 上部カバーをサーバからまっすぐ持ち上げ、横に置きます。
- ステップ2 次のようにして、上部カバーを取り付けます。
 - a) ラッチが完全に開いた位置にある状態で、カバーを、前面カバー パネルのへりから約2分の1インチ (1.27 cm)後方のサーバ上部に置きます。ラッチの開口部をファン トレイから上に突き出ているペグ に合わせます。
 - b) 閉じた位置までカバー ラッチを押し下げます。ラッチを押し下げながら、カバーを閉じた位置まで前 方に押します。
 - c) 必要に応じて、ドライバを使用しロックを時計回りに 90 度回転させて、ラッチをロックします。

図 4:上部カバーの取り外し



2	ロッキング カバー ラッチ	

シリアル番号の場所

サーバのシリアル番号はサーバ上部、前面近くのラベルに印刷されています。

ホット スワップとホット プラグ

一部のコンポーネントは、シャットダウンおよびサーバの電源切断を行わなくても、取り外し と交換が可能です。交換には、ホットスワップとホットプラグの2つの種類があります。

- ホットスワップ交換:ソフトウェアまたはオペレーティングシステムでコンポーネントを シャットダウンする必要がありません。これは、次のコンポーネントに適用されます。
 - SAS/SATA ハード ドライブ
 - SAS/SATA ソリッド ステート ドライブ
 - 冷却ファン モジュール
 - ・電源(2+2または1+1 冗長の場合)
- ホットプラグ交換:次のコンポーネントを取り外す前に、オフラインにする必要があります。
 - NVMe PCIe ソリッド ステート ドライブ

サービス可能なコンポーネントの場所

ここでは、フィールドで交換可能なコンポーネントとサービス関連の品目の場所を示します。

サポートされるコンポーネントの部品番号などの、このサーバのすべてのバージョンの技術仕 様シートは、『Cisco UCS Servers Technical Specifications Sheets』に記載されています(「*Technical Specifications*」まで下へスクロールしてください)。

- •主要シャーシ内でサービス対象のコンポーネント (13ページ)
- CPU モジュール内のサービス対象のコンポーネント (17ページ)
- •I/O モジュール内のサービス対象のコンポーネント (18ページ)



図 5: 主なシャーシ内のサービス対象のコンポーネント ロケーション



I

2	前面取り付け用 RAID コントローラ カード (このビューに表示されません。CPU モ ジュールの下のシャーシフロア近くにありま す。) 前面の RAID コントローラの supercap (RAID バックアップ) (このビューに表示されません。CPU モ ジュールの下のシャーシフロア近くに取り付 けブラケットがあります。)	11 12	PCIe スロット01: Cisco UCS VIC アダプタカー ドのプライマリスロット。 (Cisco UCS VIC のセカンダリスロットはス ロット02 です。) 高電力 GPU カード (6) の電源コネクタ
3	ファンモジュール(4つのモジュールにそれ ぞれ 2 つのファン、ホットスワップ可能)	13	マザーボード上のトラステッドプラットフォー ム モジュール ソケット
4	補助背面ドライブ モジュールの空気ディ フューザー 背面ドライブ モジュールで SAS/SATA ドラ イブを使用する場合にのみ、このディフュー ザーが必要です。	14	CPU モジュール(最大 2 台、フォントの読み 込み)
5	背面の RAID コントローラの supercap ユニッ ト (RAID バックアップ)の位置。 Supercap のクリップは、空気ディフューザー の表面にあります。	15	 左側のベイモジュール(ドライブベイ1~8) ・ベイ1、2、7、8はSAS/SATAまたは NVMeドライブをサポートします。 前面NVMeドライブは、単一のCPUモジュールシステムではサポートされません。 ・ベイ3、4、5、6はSAS/SATAドライブのみサポートします。 (注) NVMe専用の前面ドライブモジュールは、最大8NVMeSSDをサポートできます。SAS/SATAモジュールを 搭載したこのNVMe専用モジュールを を混在させたり、フィールドのモジュールの種類を変更することはできません。

I

i		l	
6	補助背面ドライブモジュール。いずれかを装	16	中央のベイモジュール(ドライブベイ9~16)
	備します(混在ではない)。 • 最大 8 台の 2.5 インチ SAS/SATA ドライ		 ・ベイ 9、10、15、16 は SAS/SATA または NVMe ドライブをサポートします。
	ブ ・最大8台の2.5インチNVMeSSDドライ ブ		前面 NVMe ドライブは、単一の CPU モ ジュール システムではサポートされませ ん。
			• ベイ 11、12、13、14 は SAS/SATA ドライ ブのみサポートします。
7	マザーボード上の内部 USB 2.0 ソケット	17	右側のベイ モジュールではいずれかをサポー トしています。
			 ・ドライブ ベイ 17~24 (表示)
			 ベイ 17、18、23、24 は SAS/SATA または NVMe ドライブをサポートします。
			前面 NVMe ドライブは、単一の CPU モジュール システムではサポートさ れません。
			 ・ベイ 19、20、21、22 は SAS/SATA ド ライブのみサポートします。
			• オプションの DVD ドライブ モジュール
8	PCIe スロット 1 - 12	18	I/Oモジュール
	PCIe スロットの仕様は PCIe スロットの仕様 および制約事項(71ページ)を参照してく ださい。		 (注) I/Oモジュールはフィールド交換不可 であり、1つのシャーシから別の シャーシに I/O モジュールを移動す ることもできません。このモジュー
	(補助内部ドフイブケージを内部クリアランスのため使用すると、PCIe スロット 12 は使用できません。		ルには、工場出荷時と同じシャーシ でPCIeモジュールを維持する必要が あるセキュリティ チップが含まれて います。

9	 PCIe スロット 11:背面ドライブモジュールがSAS/SATAドライブで使用されるときの背面 RAID コントローラのデフォルト スロット。 (注) 1台のみの CPU モジュールを使用するシステムでは、スロット 11 はサポートされていません。この場合、背面 RAID コントローラはスロット 10 に取り付ける必要があり、ブランキングパネルはスロット11 に取り付ける必要があります。 	19	電源1~4 (ホットスワップ可能、2+2 (デフォ ルト)または3+1として冗長) システム内のすべての電源モジュールは、同一 である必要があります(混在なし)。
10	PCIe スロット 10:背面ドライブモジュール が NVMe SSD を使用するとき NVMe スイッ チカードに必要なスロット。 このスロットは、1台のみのCPUモジュール のシステムで背面 RAID コントローラに使用 する必要があります。	-	



1	CPU の数は、CPU モジュールの場所に応じ て異なります。	4	CPU1または3によって制御される DIMM ソ ケット(チャネルA、B、C、D、E、F)
	 CPU2およびヒートシンク(モジュール が下部ベイ1である場合) 		
	• CPU4およびヒートシンク(モジュール が上部ベイ 2 である場合)		
	 (注) CPU モジュール1の CPU は、CPU モジュール2(混在なし)の CPU と同じである必要があります。 		
2	CPU2 または4によって制御されるDIMM ソ ケット(チャネルG、H、J、K、L、M)。	5	モジュールのリリース レバー(2 つの各モ ジュール)
	DIMM スロットの番号については、DIMM の 装着規則とメモリパフォーマンスに関するガ イドライン (93 ページ)を参照してくださ い。		

CPU モジュール内のサービス対象のコンポーネント

図 6: CPU モジュール内のサービス対象のコンポーネントの場所

3	CPUの数は、CPUモジュールの場所に応じ - て異なります。	
	• CPU1およびヒートシンク(モジュール が下部ベイ1である場合)	
	• CPU 3 およびヒートシンク(モジュール が上部ベイ 2 である場合)	
	 (注) CPUモジュール1のCPUは、CPU モジュール2(混在なし)のCPU と同じである必要があります。 	

I/0 モジュール内のサービス対象のコンポーネント

図 7: I/O モジュール内のサービス対象のコンポーネントの場所



1	Micro SD カード スロット	3	RTC バッテリの垂直ソケット
2	ミニ ストレージ モジュール ソケット。次の オプションがあります。	-	
	•2 台の SD カード スロットを備えた SD カード モジュール。		
	•2 台の SATA M.2 ドライブまたは 2 台の NVMe M.2 ドライブ用のスロットを備え た M.2 モジュール		

主要シャーシ内でコンポーネントの交換

A

警告 ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉(EMI)の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

ステートメント 1029

 Λ

注意 損傷を防ぐため、サーバコンポーネントを取り扱う際には、必ずキャリアエッジを持ち、静 電気防止用(ESD)リストストラップやその他の接地装置を使用してください。

\mathcal{P}

ヒント 前面パネルまたは背面パネルにあるユニット識別ボタンを押すと、サーバの前面パネルと背面 パネル上の青いユニット識別 LED が点滅します。このボタンの確認によって、ラックの反対 側に移動しても対象のサーバを特定できます。これらの LED は、Cisco IMC インターフェイス を使用してリモートでアクティブにすることもできます。

このセクションでは、メインシャーションポーネントの取り付けと交換の方法について説明 します。関連項目:

- CPU モジュール内のコンポーネントの交換 (76 ページ)
- I/O モジュール内のコンポーネントの交換 (103 ページ)

CPU モジュールの交換

CPU モジュール入力ルール:

- サーバは1台または2台のCPUモジュールを操作できます。
- CPU モジュールが1台しかない場合、まず下部ベイ1を設定します。
- CPU モジュールが上部ベイ2に存在しない場合、ベイ2に空のフィラーモジュールを挿入する必要があります。挿入しない場合、システムが起動しません。
- 2 台の CPU 構成のみ(CPU モジュール 2 が存在しない)を使用すると、次の制限が適用 されます。
 - ・DIMMの最大数は、24(CPU1および2のCPUメモリのチャネルのみ)です。
 - ・CPUモジュール2が存在しない場合は、いくつかのPCleスロットを利用できません。

CPU モジュール1によって制御されてい る PCIe スロット	CPU モジュール 2 によって制御されてい る PCIe スロット
(CPU 1 および 2)	(CPU 3 および 4)
1、2、5、8、9、10	3、4、6、7、11、12

- PCIe スロット1、2、8、および10で、4 台のダブルワイド Gpu のみがサポートされます。
- •前面 NVMe ドライブはサポートされていません。
- オプションNVMe専用ドライブベイのモジュールでは、UCSC-C480-8NVMEはサポートされていません。
- ・背面の RAID コントローラが使用されている場合は、デフォルト スロット 11 ではなく、PCIe スロット 10 に取り付ける必要があります。空のフィルタは、スロット 11 に取り付ける必要があります。

(注) 各 CPU モジュールには、前面に障害を知らせるオレンジになる LED があり、どの CPU モ ジュールに障害が発生しているのか特定するのに役立ちます。

∕!∖

- 注意 シャットダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPU モジュールを削除しないでくだ さい。
- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を参照)。

CPU モジュールはシャーシの前面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、カバーを 取り外す必要はありません。

- **ステップ2** 既存の CPU モジュールを取り外します。
 - (注) モジュールを取り外す前に、CPU モジュールの前面の電源 LED がオフあることを確認します。
 - a) モジュール上の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外し ます。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。

図 8: CPU モジュールの前面



- **ステップ3**古いCPUモジュールから新しいCPUモジュールにCPUを移動する場合は、M5世代CPUの移動(87ページ)参照してください。
- ステップ4 古い CPU モジュールから 新しい CPU モジュールに DIMM を移動する場合は、次の手順を実行します。
 - a) DIMM スロットの両端にあるイジェクトレバーを開き、古いCPUモジュールボードからう上にDIMM を引き上げます。
 - b) 新しい CPU モジュール ボードで、空のスロットに新しい DIMM を合わせます。DIMM スロット内の 位置合わせ機能を使用して、DIMM を正しい向きに配置します。
 - c) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DIMM の 上部の角を均等に押し下げます。
- ステップ5 シャーシに新しい CPU モジュールを取り付けます。
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、新しい CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モ ジュールをベイに押し込みます。
 - c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェ クトレバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ1** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
 - (注) CPU モジュールの前面の電源 LED が緑色に点灯していることを確認します。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換

(注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

サーバの前面ドライブは、3つのリムーバブルドライブベイモジュールに取り付けられます。

図 *9:* ドライブ ベイの番号付け



- SAS/SATA/NVMe ドライブ ベイ モジュール(UCSC C480 8HDD):
 - 左側のドライブ ベイ モジュール:ベイ 1、2、7、8 では SAS/SATA または NVMe ド ライブをサポート。ベイ 3、4、5、6 では SAS/SATA ドライブのみサポート。

- (注) 前面NVMeドライブは、1台のみのCPUモジュールを使用するシ ステムではサポートされません。
- 中央ドライブベイモジュール:ベイ9、10、15、16ではSAS/SATAまたはNVMeドライブをサポート。ベイ11、12、13、14ではSAS/SATAドライブのみサポートします。
- •右側のベイモジュール:ベイ17、18、23、24ではSAS/SATAまたはNVMeドライブ をサポート。ベイ19、20、21、22ではSAS/SATAドライブのみサポート。

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って ください。

- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
- •1 台のサーバに SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができま す。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成 することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべての SAS/SATA ハード ドライブまたはすべての SAS/SATA SSD を含める必要があります。

4K セクター形式の SAS/SATA ドライブの考慮事項

- •4K セクター形式のドライブはレガシー モードではなく UEFI モードで起動する必要があります。この項の手順を参照してください。
- 同じRAIDボリュームの一部として4Kセクター形式および512バイトセクター形式のドライブを設定しないでください。
- 4K セクターのドライブでのオペレーティング システムのサポートは次のとおりです。
 Windows: Win2012、Win2012R2、Linux: RHEL 6.5、6.6、6.7、7.0、7.2、SLES 11 SP3 および SLES 12。ESXi/VMware はサポートされません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1		

BIOS セットアップ ユーティリティでの UEFI モード起動の設定

ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替えます。

- ステップ2 [Boot Options] タブに移動します。
- ステップ3 [UEFI Boot Options] を [Enabled] に設定します。
- **ステップ4** [Boot Option Priorities] の下で、OS のインストールメディア(仮想 DVD など)を [Boot Option #1] として設定します。
- ステップ5 [Advanced] タブに移動します。
- ステップ6 [LOM and PCIe Slot Configuration] を選択します。
- ステップ7 [PCIe Slot ID: HBA Option ROM] を [UEFI Only] に設定します。
- **ステップ8** F10を押して変更内容を保存し、BIOSセットアップユーティリティを終了します。サーバをリブートできます。
- ステップ9 OS をインストールしたら、次のようインストールを確認します。
 - a) ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替えます。
 - b) [Boot Options] タブに移動します。
 - c) [Boot Option Priorities] の下で、インストールした OS が [Boot Option #1] にリストされていることを確認します。

Cisco IMC GUI での UEFI モード起動の設定

ステップ1 Web ブラウザとサーバの IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI 管理インターフェイスにログインします。

- **ステップ2** [Server] > [BIOS] に移動します。
- ステップ3 [Actions] の下の [Configure BIOS] をクリックします。

- **ステップ4** [Configure BIOS Parameters] ダイアログで、[Advanced] タブをクリックします。
- **ステップ5** [LOM and PCIe Slot Configuration] セクションに移動します。
- ステップ6 [PCIe Slot: HBA Option ROM] を [UEFI Only] に設定します。
- ステップ7 [Save Changes] をクリックします。ダイアログが閉じます。
- ステップ8 [BIOS Properties] の下で [Configured Boot Order] を [UEFI] に設定します。
- **ステップ9** [Actions] で [Configure Boot Order] をクリックします。
- **ステップ10** [Configure Boot Order] ダイアログで、[Add Local HDD] をクリックします。
- ステップ11 [Add Local HDD] ダイアログで、4K セクターフォーマット ドライブの情報を入力し、それをブート順序の先頭にします。
- ステップ12 変更を保存し、サーバをリブートします。この変更はシステムのリブート後に確認できます。

フロントローディング SAS/SATA ドライブの交換



- (注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。
- ステップ1 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランクドライブトレイを取り外します。
 - a) ドライブトレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - b) イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブトレイネジを外し、トレイからドライブを取り外します。
- **ステップ2** 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - (注) スロットにドライブ トレイを挿入するとき、ドライブ トレイの LED は上側にある必要があ ります。イジェクト レバーを上に閉じます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。

図 10: ドライブ トレイ内のドライブの交換



背面(内部) SAS/SATA ドライバの交換

(注)

SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。

背面 SAS/SATA ドライブの装着に関するガイドライン

サーバは、最大8台の2.5インチドライブを保持する、内部、背面ドライブベイモジュール をサポートします。

- SAS/SATA ドライブを使用するとき、8 台のドライブはすべて SAS/SATA である必要があり、NVMe ドライブを混在させることはできません。
- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。
- ケージに SAS/SATA ハード ドライブと SAS/SATA SSD を混在させることができます。ただし、ハード ドライブと SSD が混在する論理ボリューム(仮想ドライブ)を構成することはできません。つまり、論理ボリュームを作成するときは、すべての SAS/SATA ハードドライブまたはすべての SAS/SATA SSD を含める必要があります。

(注) 4K セクター形式の SAS/SATA ドライブの考慮事項 (23 ページ)も参照してください。



図 11: 内部ドライブモジュール ベイ(トップビュー)

背面 SAS/SATA ドライブの要件

次の要件に従います。

- ・オプションの背面ドライブモジュール(UCSC C480 8HDD)。
- ・背面ドライブ モジュールは最小 Cisco IMC および BIOS 3.1(3) それ以降が必要です。
- ・背面のドライブベイモジュールは、SAS/SATAドライブが取り付けられているとき、空気ディフューザーUCSC-DIFF-C480M5が取り付けられている必要があります。
- RAID サポート: PCIe スロット 11 に取り付けられている RAID コントローラ カード (UUCSC SAS9460 8i)。



- (注) 1 台のみの CPU モジュールを備えるシステムでは、この RAID コントローラは PCIe スロット 10 に取り付ける必要があり、スロット 11 に十分なエアー フローを確認する空のフィルターが必要です。
- RAID サポート: RAID ケーブル (CBL-AUX-SAS-M5)。このケーブルは、ドライブベイ モジュールに背面の RAID カードを接続します。
- RAID サポート: Supercap RAID バックアップ ユニット(UCSC SCAP M5)。このユニットは、空気ディフューザーの内部クリップに取り付けます。これは、背面の RAID コントローラにケーブル接続します。

背面(内部)SAS/SATA ドライブの交換

(注) SAS/SATA ハード ドライブまたは SSD はホットスワップ可能であるため、交換時にサーバを シャットダウンしたり、電源をオフにしたりする必要はありません。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

- a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。
 - 注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。

b) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

- ステップ2 次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランクドライブトレイを取り外します。
 - a) ドライブトレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - b) イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをベイから引き出します。

c) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブトレイネジを外し、トレイからドライブを取り外します。

ステップ3 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。

- a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
- b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
- c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ5** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ6** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 12: ドライブトレイ内のドライブの交換



2	解除ボタン	4	ドライブ トレイから取り外したドライブ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·

フロントローディング NVMe SSD の交換

(注) OS 通知のホットインサーションとホット リムーブはシステム BIOS で有効にする必要があり ます。システム BIOS でのホットプラグサポートの有効化 (31ページ)を参照してください。



(注) OS 非通知の取り外しはサポートされていません。OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブは、VMWare ESXi を除くすべてのサポート対象オペレーティングシステムでサポートされています。

このセクションでは、前面パネルのドライブベイの2.5インチフォームファクタNVMeソリッドステートドライブ(SSD)を交換する手順を説明します。

フロントロード NVMe SSD の装着に関するガイドライン

2.5 インチ NVMe SSD の前面ドライブ ベイのサポートは、取り付けられるドライブ ベイ モジュールの種類 (NVMe 専用または SAS/SATA/NVMe)、システムの CPU モジュールの数によって異なります。



図 13: ドライブ ベイの番号付け

(注)

(注)

サポートには、システムに2つの CPU モジュールが必要です。
NVMe ドライブをサポートしている前面ドライブベイモジュールには2つの種類があります。
同じシステム内で前面ドライブモジュールの種類が混在することはありません。
• UCSC-C480-8HDD:最大4つのNVMe ドライブをそれぞれサポートする SAS/SATA/NVMe ドライブベイモジュール。
• 左側のドライブベイモジュール:ベイ1、2、7、8 では SAS/SATA または NVMe ドライブをサポートし、ベイ3、4、5、6 では SAS/SATA ドライブのみサポートします。
前面 NVMe ドライブは、単一の CPU モジュール システムではサポートされません。
• 中央ドライブベイモジュール:ベイ1、11、12、13、14 では SAS/SATA または NVMe ドライブをサポートし、ベイ11、12、13、14 では SAS/SATA または NVMe ドライブをサポートし、ベイ17、18、23、24 では SAS/SATA または NVMe ドライブをサポート。

前面 NVMe ドライブは、1 つの CPU モジュール システムではサポートされません。前面 NVMe

- 全面 NVMe ドライブは、単一の CPU モジュール システムではサポートされません。
- ・UCSC-C480-8NVME:NVMe専用ドライブベイモジュール。8個すべてのベイは、NVMe ドライブのみをサポートします。

1 つの CPU モジュール システムでは、この NVMe 専用モジュールはサポートされていま せん。

最適なパフォーマンスを得るためには、以下のドライブの装着に関するガイドラインを守って ください。

- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフローを確保します。

フロントローディング NVME SSD の要件と制約事項

次の要件に従ってください。

・システム BIOS でホットプラグのサポートを有効にする必要があります。NVMe ドライブ を搭載したシステムを発注した場合は、ホットプラグサポートが有効にされた状態で出荷 されます。システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化 (31 ページ)を参照して ください。

次の制限事項に従います。

- NVMe2.5インチSSDは、UEFIモードでの起動のみをサポートしています。レガシーブートはサポートされていません。UEFIブートの設定手順については、BIOSセットアップユーティリティでのUEFIモード起動の設定(23ページ)またはCisco IMC GUIでのUEFIモード起動の設定(23ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとインターフェイスをとるため、SAS RAID コント ローラでは NVMe PCIe SSD を制御できません。
- 同じシステムに NVMe 2.5 インチ SSD と HHHL フォームファクタ SSD を混在させること は可能ですが、同じパートナーブランドを使用する必要があります。たとえば、2 台の *Intel* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と 2 台の *HGST* HHHL フォーム ファクタ SSD は、無効な 構成です。有効な構成は、2 台の *HGST* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と、2 台の *HGST* HHHL フォーム ファクタ SSD です。
- ・サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、UEFIのブートがサポートされています。VMWare ESXiを除くサポートされているすべてのオペレーティングシステムで、ホットインサーションとホットリムーブがサポートされています。

システム BIOS でのホットプラグ サポートの有効化

ホットプラグ(OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブ)は、デフォルトでは システム BIOS で無効になっています。

- NVMe PCIe SSD を一緒に注文している場合、システムの設定は工場出荷時に有効になっています。特に対処の必要はありません。
- 工場出荷後に NVMe PCIe SSD を追加した場合、BIOS でホットプラグ サポートを有効に する必要があります。次の手順を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1		

BIOS セットアップ ユーティリティを使用したホットプラグ サポートの有効化

ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替えます。

- ステップ2 [Advanced] > [PCI Subsystem Settings] > [NVMe SSD Hot-Plug Support] に移動します。
- ステップ3 値を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 変更を保存し、ユーティリティを終了します。

Cisco IMC GUI を使用したホットプラグ サポートの有効化

- ステップ1 ブラウザを使用して、サーバの Cisco IMC GUI にログインします。
- ステップ2 [Compute] > [BIOS] > [Advanced] > [PCI Configuration] に移動します。
- ステップ3 [NVMe SSD Hot-Plug Support] を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 変更を保存します。

フロントロード NVMe SSD の交換

このトピックでは、前面パネル ドライブ ベイで 2.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を交換する手順を説明します。

(注) OS 非通知の取り外しはサポートされていません。OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブは、VMWare ESXi を除くすべてのサポート対象オペレーティングシステムでサポートされています。

- (注) OS 通知のホットインサーションとホット リムーブはシステム BIOS で有効にする必要があり ます。システム BIOS でのホットプラグサポートの有効化(31ページ)を参照してください。
- ステップ1 既存のフロントロード NVMe SSD を取り外します。
 - a) NVMe SSD をシャットダウンして OS 通知の取り外しを開始します。オペレーティング システム イン ターフェイスを使用してドライブをシャットダウンしてから、ドライブ トレイ LED を確認します。
 - ・緑:ドライブを使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
 - ・緑色、点滅:ドライバはシャットダウンコマンドに従ってアンロード中です。取り外さないでください。
 - ・消灯:ドライブが使用されていないため、安全に取り外すことができます。
 - b) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
 - c) イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをスロットから引き出します。
 - d) SSD をトレイに固定している 4 本のドライブ トレイ ネジを外し、トレイから SSD を取り外します。
- ステップ2 新しいフロントロード NVMe SSD を取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しい SSD を置き、4本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - (注) スロットにドライブ トレイを挿入するとき、ドライブ トレイの LED は上側にある必要があ ります。イジェクト レバーを上に閉じます。

- b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
- c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- ステップ3 ドライブトレイ LED を確認し、緑色に点灯するまでドライブへのアクセスを待機します。
 - 消灯:ドライブは使用されていません。
 - •緑色、点滅:ドライブはホットプラグインサーションに続いて初期化中です。
 - ・緑:ドライブを使用中で、正常に機能しています。

図 14: ドライブ トレイ内のドライブの交換



2	解除ボタン	4	ドライブ トレイから取り外したドライブ
---	-------	---	---------------------

背面 NVMe SSD の交換

(注)

主) OS非通知の取り外しはサポートされていません。OS通知のホットインサーションおよびホットリムーブは、VMWare ESXi を除くすべてのサポート対象オペレーティングシステムでサポートされています。

(注) OS 通知のホットインサーションとホット リムーブはシステム BIOS で有効にする必要があり ます。システム BIOS でのホットプラグサポートの有効化 (31ページ)を参照してください。

このセクションでは、内部の背面ドライブベイ モジュールの 2.5 インチ フォームファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブ (SSD) を交換する手順を説明します。

背面 NVMe SSD の装着に関するガイドライン

サーバは、最大8台の2.5インチドライブを保持する、背面、内部ドライブベイモジュール をサポートします。

- NVMe ドライブを使用するとき、8 台のドライブはすべて NVMe である必要があり、 SAS/SATA ドライブを混在させることはできません。
- ドライブを装着する場合は、最も番号の小さいベイから先に追加します。
- ・未使用のベイには空のドライブブランキングトレイを付けたままにし、最適なエアーフ ローを確保します。



図 15: 内部ドライブモジュール ベイ (トップビュー)

背面 NVMe SSD の要件と制約事項

次の要件に従います。

- オプションの背面ドライブベイモジュール。NVMeドライブを使用するとき、8台のドライブはすべてNVMeである必要があり、SAS/SATAドライブを混在させることはできません。
- NVMe スイッチ カード(UCSC NVME SC)。このカードは、PCIe スロット 10 に取り付ける必要があります。
- NVMe ケーブル(CBL-AUX-NVME-M5)。このケーブルは、モジュール バック プレーン に NVMe スイッチ カードを接続します。
- システム BIOS でホットプラグのサポートを有効にする必要があります。NVMe ドライブ を搭載したシステムを発注した場合は、ホットプラグサポートが有効にされた状態で出荷 されます。

次の制約事項に従ってください。

- NVMe SSD のブートは、UEFI モードでのみサポートされています。レガシーブートはサポートされていません。UEFIブートの設定手順については、BIOS セットアップユーティリティでの UEFI モード起動の設定 (23ページ)またはCisco IMC GUI での UEFI モード起動の設定 (23ページ)を参照してください。
- NVMe SSD は PCIe バス経由でサーバとインターフェイスをとるため、SAS RAID コント ローラでは NVMe PCIe SSD を制御できません。

- ・同じシステムに NVMe 2.5 インチ SSD と HHHL フォームファクタ SSD を混在させること は可能ですが、同じパートナーブランドを使用する必要があります。たとえば、2 台の *Intel* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と 2 台の *HGST* HHHL フォーム ファクタ SSD は、無効な 構成です。有効な構成は、2 台の HGST NVMe SFF 2.5 インチ SSD と、2 台の HGST HHHL フォーム ファクタ SSD です。
- ・サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、UEFIのブートがサポートされています。VMWare ESXiを除くサポートされているすべてのオペレーティングシステムで、ホットインサーションとホットリムーブがサポートされています。

背面(内部)NVMe ドライブの交換

このトピックでは、内部 ドライブ ベイで 2.5 インチ フォームファクタ NVMe SSD を交換する 手順を説明します。サーバをシャットダウンする必要はありませんが、データ損失を回避する ため取り外す前に NVMe ドライブをシャット ダウンする必要があります。

(注) OS 非通知の取り外しはサポートされていません。OS 通知のホットインサーションおよびホットリムーブは、VMWare ESXi を除くすべてのサポート対象オペレーティング システムでサポートされています。

- (注) OS 通知のホットインサーションとホット リムーブはシステム BIOS で有効にする必要があり ます。システム BIOS でのホットプラグサポートの有効化 (31ページ)を参照してください。
- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - b) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2**次のようにして、交換するドライブを取り外すか、ベイからブランクドライブトレイを取り外します。
 - a) NVMe SSD をシャットダウンして OS 通知の取り外しを開始します。オペレーティング システム イン ターフェイスを使用してドライブをシャットダウンしてから、ドライブ トレイ LED を確認します。
 - •緑:ドライブを使用中で、正常に機能しています。取り外さないでください。
 - ・緑色、点滅:ドライバはシャットダウンコマンドに従ってアンロード中です。取り外さないでください。
 - 消灯:ドライブが使用されていないため、安全に取り外すことができます。
 - b) ドライブ トレイの表面にある解除ボタンを押します。
- c) イジェクト レバーをつかんで開き、ドライブ トレイをベイから引き出します。
- d) 既存のドライブを交換する場合は、ドライブをトレイに固定している4本のドライブ トレイ ネジを外 し、トレイからドライブを取り外します。
- ステップ3 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。
 - a) 空のドライブ トレイに新しいドライブを置き、4 本のドライブ トレイ ネジを取り付けます。
 - b) ドライブ トレイのイジェクト レバーを開いた状態で、ドライブ トレイを空のドライブ ベイに差し込 みます。
 - c) バックプレーンに触れるまでトレイをスロット内に押し込み、イジェクト レバーを閉じてドライブを 所定の位置に固定します。
- ステップ4 ドライブトレイ LED を確認し、緑色に点灯するまでドライブへのアクセスを待機します。
 - 消灯: ドライブは使用されていません。
 - ・緑色、点滅:ドライブはホットプラグインサーションに続いて初期化中です。
 - ・緑:ドライブを使用中で、正常に機能しています。
- **ステップ5** サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ1 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 16: ドライブ トレイ内のドライブの交換



HHHL フォームファクタ NVMe ソリッド ステート ドライブの交換

ここでは、PCIeスロットのハーフハイト、ハーフレングス(HHHL)フォームファクタNVMe SSDの交換について説明します。

HHHL SSD の装着に関するガイドライン

HHHL フォームファクタの NVMe SSD を取り付けるときは、次の装着に関するガイドライン に従ってください。 • デュアル CPU モジュール システム: PCIe スロット1~12を使用して最大12台の HHHL フォームファクタ SSD を取り付けることができます。



- (注) 取り付けられている他のコンポーネントにより、PCIeスロットの 使用可能数に影響します。次に例を示します。
 - ・補助の場合、内部のドライブモジュールが取り付けられ、 PCIeスロット12は内部クリアランスにより使用できません。
 - ・サーバに背面 RAID コントローラカードがある場合、PCIeスロット11(または単一 CPU モジュール システムのスロット10)に取り付ける必要があります。
 - ・サーバに背面 NVMe スイッチ カードがある場合は、PCIe スロット 10 に取り付ける必要があります。
- ・単一 CPU モジュール システム:単一の CPU モジュール システム (CPU モジュール 2 が存在しない)で、PCIe スロット 3、4、6、7、11 および 12 は利用できません。したがって、装着可能な HHHL フォーム ファクタ SSD の最大数は 6 台で、(PCIe スロット 1、2、5、8、9、10 を使用)になります。

CPU モジュール数	サポートされる PCIe スロット			
デュアル CPU モジュール システム(4 台の CPU)	1-12 (すべて)			
単一 CPU モジュール システム (2 CPU)	1、2、5、8、9、10			

HHHL フォームファクタ NVME SSD の制限事項

次の制限事項に従います。

- ・HHHL フォームファクタ NVMe SSD から起動することはできません。
- NVMe SSD インターフェイスは、PCIe バス経由でサーバに接続するため、SAS RAID コン トローラでは HHHL NVMe SSD を制御できません。
- ・同じシステムに NVMe SFF 2.5 インチまたは 3.5インチ SSD と HHHL フォームファクタ SSD を混在させることは可能ですが、同じパートナー ブランドを使用する必要がありま す。たとえば、2 台の *Intel* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と 2 台の *HGST* HHHL フォーム ファ クタ SSD は、無効な構成です。有効な構成は、2 台の *HGST* NVMe SFF 2.5 インチ SSD と、2 台の *HGST* HHHL フォーム ファクタ SSD です。

HHHL NVMe ドライブの交換

- **ステップ1** 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 スロット(またはブランキングパネル)から、既存のHHHLドライブを取り外します。
 - a) HHHL ドライブを取り外す PCIe スロットの上部をカバーするヒンジ付きリテーナ バーを開きます。
 指先を使ってリテーナ バーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、バーを動かして開き Pcle スロットの上部を露出させます。
 - b) HHHL ドライバのカードの両端を垂直に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。
- ステップ3 新しい HHHL ドライブを取り付けます。
 - a) PCIe ソケットと HHHL ドライブのカードの端を慎重に合わせます。
 - b) カードの両方の角を押して、コネクタをソケットに装着します。
 - c) PCIe スロットの上側のヒンジリテーナバーを閉じます。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、動かして閉じて Pcle スロットの上部をロックします。ワイヤロックラッチングを前のロック位置に押し戻します。

- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ5** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ6** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。





前面ドライブベイ モジュールの交換

前面ドライブベイは、それぞれ8個のベイを持つ3個のリムーバブルドライブベイモジュー ル間で分割されています。ドライブベイモジュールには、次の2つのタイプがあります。

- ・SAS/SATA と NVMe(UCSC C480 8HDD)
- NVMe のみ (UCSC C480 8NVME)

(注) 同一シャーシ上でのこれら2種類のモジュールの混在はサポートされていません。

- **ステップ1** サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。

- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** 整理のためシャーシから CPU のすべてのモジュールを取り外します。
 - a) モジュール上の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外 します。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- **ステップ5** 既存のドライブ ベイ モジュールを取り外します。
 - a) 既存のモジュールからすべてのドライブを取り外し、横に置きます。
 - b) シャーシの上部から、シャーシブレースにモジュールを固定する非脱落型ネジを1個緩めます。
 - c) モジュールの背面からすべての SAS ケーブルを外します。
 - d) シャーシの前面からモジュールを引き出します。
 - e) シャーシの前面からモジュールとアタッチドインターポーザボードを引き出し、横に置いておきま す。
- **ステップ6**新しいドライブモジュールを取り付けます。
 - a) シャーシ前面の開いている部分に、アタッチドインターポーザと新しいモジュールを挿入します。
 - b) 開いている部分にモジュールをゆっくり差し込み、インターポーザボードの端のコネクタがシャーシミッドプレーンのソケットにかみ合っていることを確認します。モジュールの前面の端がシャーシに均等に合うまで押します。
 - c) モジュールをシャーシに固定する固定ネジを1個取り付けます。
- **ステップ7** 以前取り外した SAS ケーブルを新しいドライブ モジュールに接続します。
- **ステップ8** 新しいモジュールのベイにドライブを取り付けます。
- **ステップ9** CPU モジュールをシャーシに再び取り付けます:
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、新しい CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーンコネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モジュールをベイに押し込みます。
 - c) 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ10** サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ11** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ12** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。



図 18:前面ドライブベイモジュールの固定ネジ(CPUモジュールは取り外し済み)

306267

1	サーバ前面(両方の CPU モジュールが 取り外された状態の前面コンパートメ ントの図)	3	ドライブベイモジュールを固定する取り 付けネジ(各モジュールに1個)
2	シャーシブレース		

前面 RAID コントローラ カードの交換

このサーバのストレージ コントローラの詳細については、サポートされるストレージ コント ローラとケーブルを参照してください。

サーバでは、最大 24 個の SAS/SATA ドライブを制御可能な、1 枚の前面 RAID コントローラ カードをサポートしています。カードはシャーシ ミッド プレーンの専用の水平ソケットに差 し込みます。ソケットはCPUモジュールの下にあり、CPUモジュールが取り外された後、サー バの上部からアクセスできます。

ストレージョントローラ上のファームウェアに、サーバ上にインストールされている Cisco IMC および BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。互換性 がない場合は、Host Upgrade Utility(HUU)を使用して、ストレージョントローラのファーム ウェアを互換性のあるレベルにアップグレードまたはダウングレードしてください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバコ ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、 ご使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。



- (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:前面コントローラハードウェア (UCSC-RAID-M5HD)を交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョ ンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) コントローラのファーム ウェアの更新を実行する必要があります。これは、サーバ SKU に正しい値をコントローラの suboem id をプログラムするために必要です。これを行わないと、ソフトウェアでドライブ列 挙が正しく表示されない場合があります。この問題は、UCSMモードのサーバの制御には影響 しません。
- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。

- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 整理のためシャーシから CPU のすべてのモジュールを取り外します。
 - a) モジュール上の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外し ます。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- **ステップ3** サーバから既存の前面 RAID コントローラ カードを取り外します。
 - a) 既存のカードから SAS および supercap ケーブルを取り外します。
 - b) RAIDカードの前面の端に固定してある金属製リテーナプレートを外します。2つの非脱落型ネジを緩め、シャーシからプレートを持ち上げ、脇に置いておきます。
 - c) カードのイジェクトレバーを開き、ミッドプレーン水平ソケットから取り外します。
 - d) カードの両端を水平に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。
- ステップ4 新しい前面 RAID コントローラ カードを取り付けます。
 - a) ミッドプレーンの専用の水平ソケットとカードの端を慎重に合わせます。
 - b) カードの両方の角を押して、コネクタをソケットに装着します。
 - c) カードのイジェクトレバーを完全に閉じ、ソケットにカードを固定します。
 - d) 金属製リテーナ プレートを再度取り付けます。2 つのねじ式スタンドオフを合わせ、両方の非脱落型 ネジを締めます。
 - e) 新しいカードに SAS と supercap ケーブルを再接続します。

カードコネクタ A1-A2 は SAS ドライブ ベイ1 に接続します。カードコネクタ B1-B2 は to SAS ドラ イブ ベイ2 に接続します。カードコネクタ C1-C2 は SAS ドライブ ベイ3 に接続します。

- ステップ5 CPU モジュールをシャーシに再び取り付けます:
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、新しい CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モ ジュールをベイに押し込みます。
 - c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェ クトレバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ6** サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ7 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ8 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
- **ステップ9** スタンドアロン モードでサーバが実行されている場合、Cisco UCS Host Upgrade Utility を使用してコント ローラ ファームウェアを更新し、コントローラの正しい suboem id をプログラムします。

 (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:前面コントローラハードウェア (UCSC-RAID-M5HD)を交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと 同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) コントローラのファームウェアの 更新を実行する必要があります。これは、サーバ SKU に正しい値をコントローラの suboem id を プログラムするために必要です。これを行わないと、ソフトウェアでドライブ列挙が正しく表示 されない場合があります。この問題は、UCSM モードのサーバの制御には影響しません。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバコン ポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUUガイドに用意されている、ご使用 の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

図 19:前面 RAID コントローラ カードの場所 (CPU モジュールは取り外した状態)



2	金属製リテーナ プレート固定ネジ		
---	------------------	--	--

前面 RAID Supercap ユニットの交換

このサーバでは、supercap ユニットの取り付けを最大2個までサポートし、1つは前面 RAID コントローラ用、1つは背面 RAID コントローラ用です。前面 supercap ユニットは、CPU モ ジュールの下の内部シャーシ壁にブラケットを取り付けます。

SuperCapは、キャッシュのNANDフラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディ スク ライトバック キャッシュ DRAM を約3年間バックアップします。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 整理のためシャーシから CPU のすべてのモジュールを取り外します。
 - a) モジュール上の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外し ます。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- ステップ3 既存の supercap ユニットを取り外します。
 - a) 既存の Supercap から Supercap ケーブルを外します。
 - b) ブラケットに supercap ユニットを取り付けている上部の保護タブでゆっくりと持ち上げます。
 - c) ブラケットから Supercap を持ち上げて外し、横に置きます。
- ステップ4 新しい supercap ユニットを取り付けます。
 - a) ブラケットに supercap ユニットを設定する間、ブラケットの上部の保護タブをゆっくりと持ち上げま す。タブを緩め、SuperCap の上にかぶるように閉じます。
 - b) Supercap ケーブルを RAID コントローラ カードから新しい Supercap ケーブルのコネクタに接続しま す。
- **ステップ5** CPU モジュールをシャーシに再び取り付けます:
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、新しい CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モ ジュールをベイに押し込みます。

c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェ クトレバーを中央に向けて回転させます。

ステップ6 サーバに上部カバーを戻します。

- **ステップ1** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ8 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 20:前面 Supercap ブラケットの場所 (下の CPU モジュール)



1	内部シャーシ壁の supercap ブラケットの	-	
	場所(示されている前面コンポーネント		
	の図では CPU モジュールが取り外され		
	た状態です)。		

背面(内部)ドライブベイ モジュールの交換

オプションの背面のドライブベイモジュールでは、8個のドライブベイを提供します。

(注) 背面のドライブベイモジュールを使用すると、PCIeスロット12に十分なスペースがないため 使用できません。

- (注) 背面のドライブ ベイ モジュールが SAS/SATA ドライブとともに使用される場合、空気ディ フューザーを取り付ける必要があります。
- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。
- **ステップ2**上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出してく ださい。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ4 既存の背面ドライブベイモジュールを取り外します。
 - a) 既存のリア ドライブ ベイ モジュールからすべてのドライブを取り外し、横に置きます。
 - b) 空気ディフューザーがモジュールに存在する場合は、ディフューザーを取り外します。ディフューザー をまっすぐ持ち上げ、横に置きます。

ディフューザーから背面 supercap ユニットを取り外す必要はありません。

- c) RAID コントローラからケーブルを外すか、モジュール コネクタから NVMe スイッチ カードを外しま す。
- d) モジュールをシャーシに固定する2本のネジを緩めます。
- e) 各端のモジュールをつかみ、均等に持ち上げて、マザーボードのソケットからコネクタを外します。
- ステップ5 新しい背面ドライブベイモジュールを取り付けます。
 - a) 新しいモジュールレベルを持ちながら、マザーボードのソケットと2つのネジ穴を合わせてください。

サーバの保守

- c) モジュールをシャーシに固定する2本のネジを取り付けます。
- d) RAID カードからケーブルを接続するか NVMe スイッチ カード を新しいモジュール バック プレーン に接続します。
- e) 以前1つ取り外している場合は、モジュールに空気ディフューザーを再度取り付けます(モジュール が SAS/SATA ドライブとともに使用される場合にのみ必要)。
 - (注) 単一の CPU モジュールを持つシステムでは、PCIe スロット 11 十分な空気循環を確保するため追加フィラーパネルが必要です。詳細については、「背面 RAID コントローラカードの交換(56ページ)」を参照してください。
- f) 新しいモジュールのベイにドライブを取り付けます。
- ステップ6 サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ1** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ8 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 21: 内部の背面ドライブ モジュール



1	空気ディフューザー上部の表示	4	シャーシフロアのアライメントフランジ
	背面ドライブ モジュールに SAS/SATA drivs が取り付けられている場合、この ディフューザーが必要です。		
2	シャーシの中間に対するディフューザー アライメント ポイント	5	2 個のドライブ モジュール固定ねじ
3	ディフューザー内部の表面の背面 RAID supercap ユニットの場所	-	

背面ドライブ モジュールの空気ディフューザーの交換

SAS/SATA ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブが取り付けられているとき、背面ドライブモジュールに空気ディフューザー UCSC BAFF C480 M5 を取り付ける必要があります。ディフューザーには、その内部表面の背面 supercap ユニットのクリップを含みます。

- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 空気ディフューザーを取り外します。:
 - a) ディフューザーの2つの上位エッジを持ち、シャーシの中間の溝から上にまっすぐ持ち上げます。
 - b) Supercap ユニットディフューザーの内部クリップに存在する場合、クリップから supercap をゆっくり 動かし、横に置いておきます。supercap ケーブルは取り外さないでください。
- ステップ3 新しい空気ディフューザーを取り付けます。
 - a) 空気ディフューザーの内部にあるクリップに supercap ユニットをセットし、場所にぴったりとはまり 固定されるまでゆっくり押します。
 - b) ディフューザーの取り付けの邪魔にならないように、SASおよび supercap ケーブルを配置します。ケー ブルはディフューザーの背面をルーティングする必要があります。
 - c) ガイドに従いシャーシの中間でグローブを使用し、ディフューザーを適切な位置にセットし、慎重に 下げていきます。シャーシフロア上と Pcle スロット 11 にディフューザー アライメント フランジが装 着されていることを確認します。

ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。

サーバの保守

- **ステップ5** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ6 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 22: 背面ドライブモジュール空気ディフューザー



1	空気ティフューサー上部の表示 背面ドライブ モジュールに SAS/SATA drivs が取り付けられている場合、この ディフューザーが必要です。	3	ティフューザー内部の表面の背面 RAID supercap ユニットの場所
2	シャーシの中間に対するディフューザー アライメント ポイント	4	シャーシフロアのアライメントフランジ

背面 RAID Supercap ユニットの交換

このサーバでは、supercap ユニットの取り付けを最大2個までサポートし、1つは前面 RAID コントローラ用、1つは背面 RAID コントローラ用です。背面 supercap ユニットは、内部ドラ イブ モジュール周りの空気ディフューザーのクリップに取り付けます。 SuperCapは、キャッシュのNANDフラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディ スク ライトバック キャッシュ DRAM を約3年間バックアップします。

- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 既存の背面 supercap ユニットを取り外します。
 - a) 空気ディフューザーの2つの上位エッジを持ち、シャーシの中間の溝から上にまっすぐ持ち上げます。
 - b) 空気ディフューザー内にあるクリップから supercap ユニットを取り外します。
 - c) 背面 RAID コントローラから supercap ケーブルを外します。
- ステップ3 新しい Supercap を取り付けます。
 - a) 空気ディフューザーの内部にあるクリップに新しい supercap ユニットをセットし、場所にぴったりと はまり固定されるまでゆっくり押します。
 - b) supercap ケーブルを背面 RAID コントローラ カードに接続します。
 - c) ディフューザーの取り付けの邪魔にならないように、SAS および supercap ケーブルを配置します。ケー ブルはディフューザーの背面をルーティングする必要があります。
 - d) ガイドに従いシャーシの中間でグローブを使用し、ディフューザーを適切な位置にセットし、慎重に 下げていきます。シャーシフロア上と Pcle スロット 11 にディフューザー アライメント フランジが装 着されていることを確認します。
- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ5 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンのLEDがオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ6** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。



図 23: 背面ドライブモジュール空気ディフューザーと Supercap ユニットの場所

1	空気ディフューザー上部の表示 背面ドライブ モジュールに SAS/SATA drivs が取り付けられている場合、この ディフューザーが必要です。	3	ディフューザー内部の表面の背面 RAID supercap ユニットの場所
2	シャーシの中間に対するディフューザー アライメント ポイント	4	シャーシフロアのアライメントフランジ

背面 RAID コントローラ カードの交換

サーバでは、オプションの補助ドライブモジュールで最大で8台の内部 SAS/SATA ドライブ を制御可能な、1台の背面 RAID コントローラ カードをサポートしています。



 (注) 背面 RAID コントローラのデフォルト スロットは、PCIe スロット 11 です。ただし、単一の CPU モジュール システムでスロット 11 はサポートされません。この状況では、PCIe スロット 10 に背面 RAID コントローラを取り付け、PCIe スロット 11に十分な空気循環が行われるため に必要な空のフィルタを取り付けます。

このサーバのストレージ コントローラの詳細については、サポートされるストレージ コント ローラとケーブルを参照してください。

ストレージ コントローラ(RAID または HBA)のファームウェアに、サーバ上にインストー ルされている Cisco IMC および BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要 があります。互換性がない場合は、Host Upgrade Utility(HUU)を使用して、ストレージ コン トローラのファームウェアを互換性のあるレベルにアップグレードまたはダウングレードして ください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバコ ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、 ご使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

- (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:背面コントローラハードウェアを交換した後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU)コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。これは、サーバ SKU に正しい値をコントローラの suboem id をプログラムするために必要です。これを行わないと、ソフトウェアでドライブ列挙が正しく表示されない場合があります。この問題は、UCSM モードのサーバの制御には影響しません。
- **ステップ1** 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 既存の RAID カードを取り外します。
 - a) 既存のカードから SAS および supercap ケーブルを取り外します。
 - b) PCIe スロット 11 または 10 の上部をカバーするヒンジ付きリテーナ バーを開きます。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、バーを動かして開き Pcle スロットの上部を露出させます。PCIe カードの交換 (74ページ)を参照してください。

- c) カードの青色イジェクトレバーを開き、スロットから取り外します。
- d) カードの両端を垂直に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。

ステップ3新しい RAID コントローラ カードを取り付けます。

- a) PCIe スロット11(または単一の CPU モジュール システムの10)のソケットとカードの端を慎重に合わせます。
- b) カードの両方の角を押して、コネクタをソケットに装着します。
- c) カードの青色のイジェクト レバーを完全に閉じ、ソケットにカードを固定します。
- d) SAS ケーブル(CBL-AUX-SAS-M5)と supercap ケーブルを新しいカードに接続します。
- e) PCIe スロットの上側のヒンジ リテーナ バーを閉じます。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、動かして閉じて Pcle ス ロットの上部をロックします。ワイヤ ロック ラッチングを前のロック位置に押し戻します。

- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ5 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ6** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
- **ステップ7** スタンドアロンモードでサーバが実行されている場合、Cisco UCS Host Upgrade Utility を使用してコント ローラファームウェアを更新し、コントローラの正しい suboem id をプログラムします。
 - (注) スタンドアロンモードのみで実行されているサーバ:背面コントローラハードウェアを交換した 後に、ファームウェアの現在のバージョンが更新バージョンと同じであった場合でも、Cisco UCS Host Upgrade Utility (HUU) コントローラのファームウェアの更新を実行する必要があります。こ れは、サーバ SKU に正しい値をコントローラの suboem id をプログラムするために必要です。こ れを行わないと、ソフトウェアでドライブ列挙が正しく表示されない場合があります。この問題 は、UCSM モードのサーバの制御には影響しません。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバコン ポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUUガイドに用意されている、ご使用 の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。



図 24: 背面 RAID カードと PCle スロット 11 フィルタ (単一の CPU モジュール システムを示す)

背面 NVMe スイッチ カードの交換

NVMe ドライブが背面ドライブ ベイに装着されるとき、PCIe スロット 10 に NVMe スイッチ カードが必要です。PCIe ケーブルは、ドライブ ベイ モジュール バック プレーンにスイッチ カードを接続します。

(注) 背面 NVMe スイッチカードが使用されている場合、PCle スロット10 に取り付ける必要があり ます。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
- b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。

ステップ2 PCIe スロット 10 から、既存の背面 NVMe スイッチ カードを取り外します。

- a) 既存のカードから PCIe ケーブルを外します。
- b) PCIe スロット 10 の上部をカバーするヒンジ付きリテーナ バーを開きます。PCIe カードの交換 (74 ページ) を参照してください。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、バーを動かして開き Pcle スロットの上部を露出させます。

- c) カードの青色イジェクトレバーを開き、PCIe スロット10から取り外します。
- d) カードの両端を垂直に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。
- ステップ3 新しい背面 NVMe スイッチ カードを取り付けます。
 - a) PCIe スロット 10 のソケットとカードの端に慎重に合わせます。
 - b) カードの両方の角を押して、コネクタをソケットに装着します。
 - c) カードの青色のイジェクトレバーを完全に閉じ、ソケットにカードを固定します。
 - d) PCIeケーブル(CBL-AUX-NVME-M5)を内部ドライブモジュールのバックプレーンから新しいスイッ チカードに接続します。
 - e) PCIe スロットの上側のヒンジリテーナバーを閉じます。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、動かして閉じて Pcle スロットの上部をロックします。ワイヤロックラッチングを前のロック位置に押し戻します。

- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ5 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ6** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。



図 25: 背面 NVMe スイッチ カードの場所 (PCle 10)

ファン モジュールの交換

サーバの4台のホットスワップ可能なモジュールは、図1のように番号が割り当てられていま す。各ファンモジュールには2つのファンが内蔵されています。

 \mathcal{P}

ヒント 各ファンモジュールの上部に、障害 LED があります。モジュールが正しく装着され、正常に 動作している場合、この LED は緑色に点灯します。モジュールに障害が発生している場合、 またはモジュールが正しく装着されていない場合、LED はオレンジ色に点灯します。

注意 ファンモジュールはホットスワップ可能なため、ファンモジュールの交換時にサーバのシャッ トダウンまたは電源の切断を行う必要はありません。ただし、適切な冷却を保てるよう、ファ ンモジュールを取り外した状態でのサーバの稼働は、1分以内にしてください。

ステップ1 既存のファンモジュールを取り外します。

- a) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- b) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- c) ファンモジュールの上部にあるリリースラッチをつかんで両側から押します。まっすぐ持ち上げ、マ ザーボードからコネクタを外します。
- **ステップ2** 次のようにして、新しいファンモジュールを取り付けます。
 - a) 新しいファン モジュールを所定の位置に置きます。ファン モジュール上部に印字されている矢印が サーバ後部に向いている必要があります。
 - b) ファン モジュールをゆっくりと押し下げて、マザーボード上のコネクタにしっかりと差し込みます。
 - c) サーバに上部カバーを戻します。
 - d) サーバをラックに再度取り付けます。

図 **26**:ファン モジュールの上面図



内部 USB ドライブの交換

ここでは、USB ドライブの取り付け、および内部 USB ポートの有効化または無効化の手順について説明します。

USBドライブの交換

サーバにはマザーボード上の1つの水平 USB 2.0 ソケットがあります。



- 注意 データ損失の可能性があるため、サーバの電源が入っている状態で内部 USB ドライブをホット スワップすることは避けてください。
- ステップ1 既存の内部 USB ドライブを取り外します。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
 - d) PCIe スロット 12 の周辺に、以下に示すようにマザーボードに USB ソケットを探します。
 - e) USB ドライブをつかみ、水平方向に引いてソケットから外します。
- **ステップ2**新しい内部 USB ドライブを取り付けます。
 - a) USB ドライブをソケットの位置に合わせます。
 - b) USB ドライブを水平方向に押して、ソケットにしっかり差し込みます。
 - c) サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ3 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ4 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 27: 内部 USB 2.0 ソケットの場所 ロケーション



内部 USB ポートの有効化または無効化

工場出荷時のデフォルトでは、サーバのすべての USB ポートが有効です。ただし、内部 USB ポートは、サーバ BIOS で有効または無効にできます。

- ステップ1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2キーを押して BIOS セットアップユーティリティに切り替えます。
- ステップ2 [Advanced] タブまで移動します。
- ステップ3 [Advanced] タブの [USB Configuration] を選択します。
- ステップ4 [USB Configuration] ページの [USB Ports Configuration] を選択します。
- **ステップ5** [USB Port: Internal] までスクロールし、Enter を押してから、ダイアログ ボックスから [Enabled] または [Disabled] を選択します。
- ステップ6 F10を押して保存し、ユーティリティを終了します。

信頼されたプラットフォーム モジュール(TPM)の取り付け

信頼されたプラットフォームモジュール(TPM)は小型の回路基板であり、マザーボードの ソケットに差し込んで、外せないように一方向ネジを使用して固定します。

TPMに関する考慮事項

- •このサーバは、TPM バージョン 1.2 または TPM バージョン 2.0 をサポートします。
- フィールドでのTPMの交換はサポートされていません。サーバにTPMが取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後にTPMを取り付けることができます。
- •既存の TPM 1.2 がサーバに取り付けられていれば、TPM 2.0 にはアップグレードできません。サーバに既存の TPM がない場合、TPM 2.0 を取り付けることができます。
- TPM 2.0 が応答しなくなると、サーバをリブートします。

TPM の取り付けおよび有効化

(注) フィールドでの TPM の交換はサポートされていません。サーバに TPM が取り付けられていない場合にのみ、工場出荷後に TPM を取り付けることができます。

ここでは、TPM を取り付けて有効にするときに、その順序で行う必要がある次の手順について説明します。

- 1. TPM ハードウェアの取り付け
- 2. BIOS での TPM の有効化
- 3. BIOS での Intel TXT 機能の有効化

TPM ハードウェアの取り付け

- (注) 安全確保のために、TPM は一方向ネジを使用して取り付けます。このネジは一般的なドライ バでは取り外せません。
- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。

- **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
- c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 次のようにして、TPM を取り付けます。
 - a) マザーボード上の TPM ソケットの場所を確認します(下の図を参照)。
 - b) TPM 回路基板の下部にあるコネクタとマザーボードの TPM ソケットの位置を合わせます。TPM ボードのネジ穴を TPM ソケットに隣接するネジ穴の位置に合わせます。
 - c) TPM を均等に押し下げて、マザーボード ソケットにしっかりと装着します。
 - d) 一方向ネジを1本取り付けて、TPM をマザーボードに固定します。
- ステップ3 サーバにカバーを戻します。
- ステップ4 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ5 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
- ステップ6 BIOS での TPM の有効化 (66 ページ) に進みます。

図 **28 : TPM** ソケットの位置



BIOS での TPM の有効化

ハードウェアを取り付けたら、BIOS で TPM のサポートを有効にする必要があります。



- (注) この手順を実行する前に、BIOS 管理者パスワードを設定する必要があります。このパスワードを設定するには、システムブート中にプロンプトが表示されたときに F2 キーを押して、 BIOS セットアップ ユーティリティを開始します。[Security]>[Set Administrator Password] を 選択し、表示されるプロンプトに応じて新しいパスワードを2回入力します。
- ステップ1 TPM サポートを有効にします。
 - a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
 - b) BIOS 管理者パスワードで、BIOS セットアップ ユーティリティにログインします。
 - c) [BIOS Setup Utility] ウィンドウで、[Advanced] タブを選択します。
 - d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
 - e) [TPM SUPPORT] を [Enabled] に変更します。
 - f) F10を押して設定を保存し、サーバを再起動します。
- **ステップ2** TPM のサポートが有効になっていることを確認します。
 - a) ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。
 - b) BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。
 - c) [Advanced] タブを選択します。
 - d) [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。
 - e) [TPM SUPPORT] と [TPM State] が [Enabled] であることを確認します。

ステップ3 BIOS での Intel TXT 機能の有効化 (67 ページ) に進みます。

BIOS での Intel TXT 機能の有効化

Intel Trusted Execution Technology (TXT) を使用すると、ビジネスサーバ上で使用および保管 される情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および 付随メモリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状 態で実行することが可能になります。Intel TXT は、暗号キーなどの機密データを保管できる 封印されたストレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩する のを防ぐために利用できます。

- ステップ1 サーバをリブートし、F2を押すように求めるプロンプトが表示されるのを待ちます。
- ステップ2 プロンプトが表示されたら、F2を押して、BIOS セットアップ ユーティリティを起動します。
- ステップ3 前提条件の BIOS 値がイネーブルになっていることを確認します。
 - a) [Advanced] タブを選択します。
 - b) [Intel TXT(LT-SX) Configuration] を選択して、[Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウを開きま す。
 - c) 次の項目が [Enabled] としてリストされていることを確認します。
 - [VT-d Support] (デフォルトは [Enabled])

- [VT Support] (デフォルトは [Enabled])
- [TPM Support]
- [TPM State]
- d) 次のいずれかを実行します。
 - [VT-d Support] および [VT Support] がすでに [Enabled] の場合、手順4に進みます。
 - [VT-d Support] および [VT Support] の両方が [Enabled] でない場合、次のステップに進み、有効にします。
- e) Escape キーを押して、BIOS セットアップ ユーティリティの [Advanced] タブに戻ります。
- f) [Advanced] タブで、[Processor Configuration] を選択し、[Processor Configuration] ウィンドウを開きます。
- g) [Intel (R) VT] および [Intel (R) VT-d] を [Enabled] に設定します。
- ステップ4 Intel Trusted Execution Technology (TXT) 機能を有効にします。
 - a) [Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウに戻ります(別のウィンドウを表示している場合)。
 - b) [TXT Support] を [Enabled] に設定します。

ステップ5 F10を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。

シャーシ侵入スイッチの交換

シャーシ侵入スイッチは、シャーシからカバーが取り外されるたびにシステムイベントログ (SEL) にイベントを記録するオプションのセキュリティ機能です。

- **ステップ1** 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- ステップ2 既存の侵入スイッチを取り外します。
 - a) マザーボードのソケットから侵入スイッチ ケーブルを外します。
 - b) No.1プラスドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシ側面に固定している1本のネジを緩めて取 り外します。
 - c) スイッチ機構をまっすぐに上にスライドさせて、シャーシのクリップから外します。
- ステップ3 新しい侵入スイッチを取り付けます。

- a) ネジ穴の位置が合うように、シャーシウォールのクリップに向けてスイッチ機構を下にスライドさせます。
- b) #1プラスドライバを使用して、スイッチ機構をシャーシウォールに固定する1本のネジを取り付けま す。
- c) マザーボードのソケットにスイッチ ケーブルを接続します。

ステップ4 サーバにカバーを戻します。

- **ステップ5** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ6 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

図 29:シャーシ侵入スイッチ



電源装置の交換

サーバには4個の電源装置が必要です。4台の電源装置を設置している場合、それらの電源装置はデフォルトで2+2で冗長です。これは、システムBIOSで3+1の冗長性を変更できます。

(注) 電源はホットスワップ可能で、サーバの外部背面からアクセス可能なため、ラックからサーバ をプルしたり、サーバカバーを削除する必要はありません。

・サポートされている電源装置の詳細については、電力仕様も参照してください。

・電源 LED の詳細については、背面パネルの LED (5 ページ) も参照してください。

AC 電源装置の交換



- **ステップ1** 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランクパネルを取り外します。
 - a) 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。
 - b) 電源モジュールのハンドルをつかみながら、リリース ラッチをハンドルのほうにひねります。
 - c) 電源装置をベイから引き出します。
- ステップ2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。
 - a) 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。
 - b) リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。
 - c) 電源コードを新しい電源装置に接続します。

図 30: AC 電源装置



1	電源装置ステータス LED	3	電源装置ハンドル
2	電源装置リリース ラッチ	-	

PCIe カードの交換



(注) シスコでは、シスコが認定および販売しているすべての PCIe カードをサポートしています。 シスコが認定も販売もしていない PCIe カードについては、お客様の責任でご使用ください。 シスコでは、C シリーズ ラックマウント サーバのサポートは常時行っておりますが、市販の 標準規格のサードパーティカードを使用しているお客様は、その特定のカードで問題が発生し た場合、そのサードパーティ カードのベンダーにご連絡していただく必要があります。

PCle スロットの仕様および制約事項

サーバは、最大12の PCIe 拡張カードの垂直取り付けのために12 個の PCIe スロットがあります。

次の図では、PCIe ソケットと背面パネルに対応する PCIe スロット開口部の上部を示します。 この時点では、いくつかの背面パネルの開口部は使用されません。 図 31: PCle スロットの番号付け



PCle スロットの仕様

表 3: PCle スロットの仕様

スロッ	電気路の	コネクタの長	カードの最大	カードの高さ(背	NCSI のサ	GPU カードの	Cisco VIC カー
ト番号	幅	さ	長	面パネル開口部)	ポート	サポート	ド サポート
1	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	対応	対応	対応 (プライマリ スロット)
2	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	対応	対応	対応
----	-----------	----------	--------	-------	----	----	-----------------
							(セカンダリ スロット)
3	Gen-3 x8	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	あり	なし	あり
4	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	対応	対応	対応
5	Gen-3 x8	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	あり	なし	あり
6	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	対応	対応	対応
7	Gen-3 x8	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	あり	なし	あり
8	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	対応	対応	対応
9	Gen-3 x8	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	なし	なし	なし
10	Gen-3 x16	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	なし	あり	なし
11	Gen-3 x8	x24 コネクタ	フルレングス	フルハイト	なし	なし	なし
12	Gen-3 x8	x8 コネクタ	フルレングス	フルハイト	なし	なし	なし

PCle 装着のガイドライン

次のガイドラインおよび制限事項に留意してください。

- PCIe ソケットの制御は、システムに存在する CPU 間で分割されています。システムに CPU モジュール 2 が取り付けられていない場合、いくつかの PCIe スロットは使用できま せん。
 - ・システムに4つのCPUがある場合、すべてのPCIeスロットがサポートされます。
 - システムに2つのCPU(CPUモジュール2が存在しない)のみがある場合、サポートされているPCIeスロットを示す次の表を参照してください。

CPU モジュール1によって制御されている	CPU モジュール 2 によって制御されている		
PCIe スロット	PCIe スロット		
(CPU 1 および 2)	(CPU 3 および 4)		
1、2、5、8、9、10	3, 4, 6, 7, 11, 12		

- ・背面ドライブベイモジュールが取り付けられている場合、PCIeスロット12は内部クリア ランスにより使用できません。
- ・サーバに背面 RAID コントローラ カードがある場合は、PCIe スロット11 またはスロット 10 に取り付ける必要があります。

・サーバに背面NVMeスイッチカードがある場合は、PCIeスロット10に取り付ける必要があります。

PCIe カードの交換

PCIe カードを取り付ける前に、PCIe スロットの仕様および制約事項 (71 ページ) 参照して ください。

- **ステップ1** 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り付ける準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - b) 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネ ルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出し てください。
 - c) サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ2** 既存のカードまたはブランク パネルを取り外します。
 - a) PCIe スロットの上部をカバーするヒンジ付きリテーナバーを開きます。
 指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、バーを動かして開き Pcle スロットの上部を露出させます。
 - b) カードの両端を垂直に引き、ソケットからカードを外して脇に置きます。
- ステップ3 次のようにして、新しい PCIe カードを取り付けます。
 - a) 背面パネル開きカードの背面タブの位置を調整しつつ、ソケットとカード端を慎重に合わせます。
 - b) カードの両方の角を押して、ソケットコネクタの端に装着します。
 - c) PCIe スロットの上側のヒンジ リテーナ バーを閉じます。

指先を使ってリテーナバーの各端にあるワイヤのロックラッチを引き戻し、動かして閉じて Pcle ス ロットの上部を固定します。ワイヤロックラッチングを前のロック位置に押し戻します。

- ステップ4 サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ5 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ6 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。



図 32: PCle スロット ヒンジ付きリテーナ バー

Cisco 仮想インターフェイス カード (VIC) に関する考慮事項

ここでは、VICカードのサポートおよびこのサーバに関する特別な考慮事項をについて説明します。

Cisco UCS Manager の統合に Cisco UCS VIC カードを使用するには、サポートされる設定、配線、およびその他の要件について、『Cisco UCS Manager 統合に適した設置方法』も参照してください。

表 4: このサーバでの VIC のサポートと考慮事項

VIC	サーバでサ ポートされる 数量	VIC をサポー トするスロッ ト	Cisco UCS Manager 統合のプライマリス ロット	Cisco Card NIC モード用のプラ イマリスロット	最小の Cisco IMC ファーム ウェア
Cisco UCS VIC 1385 UCSC-PCIE-C40Q-03	8	PCIe 1 ~ 8	PCIe 1	PCIe 1	3.1(2)
Cisco UCS VIC 1455 UCSC-PCIE-C25Q-04	8	PCIe 1 ~ 8	PCIe 1	PCIe 1	4.0(1)

Cisco UCS VIC 1495	8	PCIe 1 ~ 8	PCIe 1	PCIe 1	4.0(2)
UCSC PCIE C100 04					

- VIC カードのプライマリスロットはスロット1です。VIC カードのセカンダリスロット では、スロット2です。
- システムは、UCSM モードで最大2つの VIC カードをサポートできます。UCS Manager の管理およびデータトラフィックの両方には、スロット1に取り付けられている VICカー ドのみを使用できます。スロット2-8 に取り付けられている2番目の VIC は、データト ラフィックのみに使用されます。
- VICは1~8のスロットでサポートされます。これらの8スロットのCPUモジュール1 (CPU1および2)は、スロット1、2、5、8をサポートしています。CPUモジュール2 (CPU3および4)は、スロット3、4、6、7をサポートします。

CPU モジュール内のコンポーネントの交換

Â

注意 損傷を防ぐため、サーバコンポーネントを取り扱う際には、必ずキャリアエッジを持ち、静 電気防止用(ESD)リストストラップやその他の接地装置を使用してください。

このセクションでは、CPUモジュール内のCPUおよびDIMMを取り付けて、交換する方法について説明します。

Â

注意 シャット ダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPU モジュールを削除しないでくだ さい。

関連項目:

- 主要シャーシ内でコンポーネントの交換 (19ページ)
- •I/O モジュール内のコンポーネントの交換 (103 ページ)

CPU およびヒートシンクの交換

このセクションには、CPU モジュール内の CPU とヒートシンクを交換するための情報が含ま れています。

第二世代 Intel Xeon Scalable Processors へのアップグレードのための特別情報

```
Â
```

注意 このサーバでサポートされている第二世代の Intel Xeon Scalable processors にアップグレードす る前に、サーバのファームウェアを必要な最小レベルにアップグレードする必要があります。 古いバージョンのファームウェアは新しい CPU を認識できないため、サーバがブート不可能 になります。

第二世代 Intel Xeon Scalable processors をサポートするこのサーバで、必要な最小のソフトウェアおよびファームウェア バージョンは、次のとおりです。

表 5: 第二世代 Intel Xeon Scalable Processors の最小要件

ソフトウェアまたはファームウェア	最小バージョン
サーバ Cisco IMC	4.0(4)
サーバ BIOS	4.0(4)
Cisco UCS Manager (UCS 統合サーバのみ)	4.0(4)

次のいずれか1つの処理を実行します。

- ・サーバのファームウェアや Cisco UCS Manager ソフトウェアが上(または後で)に示されている最小の必要レベルである場合は、このセクションの手順を使用して CPU ハードウェアを交換できます。
- ・サーバのファームウェアや Cisco UCS Manager ソフトウェアが必要レベルよりも古い場合は、『Cisco UCS C- and S-Series M5 Servers Upgrade Guide for Next Gen Intel Xeon Processors』の指示に従ってソフトウェアをアップグレードします。ソフトウェアをアップグレードした後、指示通りにこのセクションに戻り、CPU ハードウェアを交換します。

CPU 構成ルール

このサーバの CPU で1台または2台の取り外し可能 CPU モジュール内部ソケットを取り付け ます。各 CPU モジュールでは、2台の CPU ソケットがあります。

- システムは、CPUモジュール1(下部ベイ)をCPU1およびCPU2として番号付けします。
- システムは、CPUモジュール2(上部ベイ)をCPU3およびCPU4として番号付けします。



・サーバは、1 つの CPU または 2 つの CPU (2 または 4 つの同型 CPU) が取り付けられた 状態で動作できます。

> (注) CPU モジュール1の CPU は、CPU モジュール2(混在なし)の CPU と同じである必要があります。

 ・最小設定は、サーバには少なくとも下部 CPU モジュール ベイに取り付けられている CPU モジュール1がある必要があります。CPU モジュール1を最初に取り付けてから、CPU モジュール2を上部ベイに取り付けます。



- (注) CPUモジュール2が上部ベイに存在しない場合は、上部ベイに空 白フィラーモジュールを装備する必要があり、そうしない場合 サーバが起動しません。
- インテル Xeon Scalable プロセッサー(第一世代)の場合:1つの CPU によって制御される12個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量は768 GB です。12個の DIMM スロットに合計768 GB を超える容量のメモリを装着するには、「M」で終わる PID を持つ大容量メモリ CPU(たとえば、UCS-CPU-6134 M)を使用する必要があります。
- 第二世代インテル Xeon Scalable プロセッサー:これらの第二世代 CPU には 3 つのメモリ 階層があります。これらの規則は、ソケット単位で適用されます。
 - CPU ソケットに最大1TB のメモリが搭載されている場合は、サフィックスのない CPU を使用できます(例: Gold 6240)。
 - CPU ソケットに最大1TB 以上(最大2TB)のメモリが搭載されている場合は、Mサ フィックスが付いた CPU(例:プラチナ 8276M)を使用する必要があります。
 - CPU ソケットに最大 2 TB 以上(最大 4.5 TB))のメモリが搭載されている場合は、L サフィックスが付いた CPU(例:プラチナ 8270L)を使用する必要があります。
- 2 台の CPU 構成のみ(CPU モジュール 2 が存在しない)を使用すると、次の制限が適用 されます。

・DIMMの最大数は、24(CPU1および2のCPUメモリのチャネルのみ)です。

・CPUモジュール2が存在しない場合は、いくつかのPCIeスロットを利用できません。

CPU モジュール1によって制御されてい る PCIe スロット	CPU モジュール 2 によって制御されてい る PCIe スロット		
(CPU1および2)	(CPU 3 および 4)		
1, 2, 5, 8, 9, 10	3, 4, 6, 7, 11, 12		

- PCIe スロット1、2、8、および10で、4 台のダブルワイド Gpu のみがサポートされます。
- ・前面 NVMe ドライブはサポートされていません。
- ・オプションNVMe専用ドライブベイのモジュールでは、UCSC-C480-8NVMEはサポートされていません。
- ・背面の RAID コントローラが使用されている場合は、デフォルト スロット 11 ではなく、PCIe スロット 10 に取り付ける必要があります。空のフィルタは、スロット 11 に取り付ける必要があります。
- 次の NVIDIA GPU は、Second Generation Intel Xeon Scalable processor ではサポートされて いません。
 - NVIDIA Tesla P100 12G
 - NVIDIA Tesla P100 16G

CPUの交換に必要な工具

この手順に必要な工具および器具は、次のとおりです。

- •T-30 トルクス ドライバ:交換用 CPU に付属。
- No.1 マイナス ドライバ:交換用 CPU に付属。
- CPU アセンブリ ツール:交換用 CPU に付属。Cisco PID UCS-CPUAT=として個別に注文 可能。
- ・ヒートシンク クリーニング キット:交換 CPU に付属。Cisco PID UCSX-HSCK=として個 別に注文可能。

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

・サーマルインターフェイスマテリアル(TIM):交換用 CPU に付属しているシリンジ。
 既存のヒートシンクを再利用する場合にのみ使用(新しいヒートシンクには、TIMのパッドがあらかじめ貼り付けられています)。Cisco PID UCS-CPU-TIM=として個別に注文可能。

1つの TIM キットが 1つの CPU をカバーします。

RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連部品 (86 ページ)も参照してください。

CPU およびヒートシンクの交換

\triangle

- 注意 CPUとそのソケットは壊れやすいので、ピンを損傷しないように十分に注意して扱う必要があ ります。CPUはヒートシンクとサーマルインターフェイスマテリアルとともに取り付け、適 切に冷却されるようにする必要があります。CPUを正しく取り付けないと、サーバが損傷する ことがあります。
- **ステップ1 注意** シャットダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPUモジュールを削除しないでください。

次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ) を参照)。
 - (注) CPU モジュールはサーバの前面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、サーバのカバーを取り外す必要はありません。
- **ステップ2** シャーシから 既存の CPU モジュールを取り外します:
 - (注) モジュールを取り外す前に、CPUモジュールの前面の電源LEDがオフあることを確認します。
 - a) CPUモジュール前面の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外 します。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- **ステップ3** 既存の CPU/ヒートシンク アセンブリを CPU モジュールから取り外します。
 - a) 交換用 CPU に付属している T-30 トルク ドライバを使用して、アセンブリをボードのスタンドオフ に固定している 4 つの非脱落型ナットを緩めます。
 - (注) ヒートシンクを水平に持ち上げるため、ヒートシンクナットを交互に均等に緩めます。ヒー トシンクナットを、ヒートシンクラベルに示されている順序(4、3、2、1)で緩めます。
 - b) CPU/ヒートシンクアセンブリをまっすぐ持ち上げ、ヒートシンクを下にして静電気防止用シートに 置きます。



1	ヒートシンク	4	マザーボード上の CPU ソケット
2	ヒートシンクの非脱落型ナット(各側 に2個)	5	T-30 トルク ドライバ
3	CPU キャリア(この図ではヒートシ ンクの下)	-	

- ステップ4 CPU アセンブリからヒートシンクを離します(CPU アセンブリは CPU とプラスチック製 CPU キャリア で構成されています)。
 - a) 次の図に示すように、CPUアセンブリが取り付けられたヒートシンクを上下が逆向きになるように 置きます。

サーマルインターフェイスマテリアル (TIM) ブレーカーの位置に注意してください。CPU キャリア上の小さなスロットの横に、TIM BREAKER と印字されています。

図 35: ヒートシンクと CPU アセンブリの切り離し



1	CPUキャリア	4	TIM ブレーカー スロットに最も近い位 置にある CPU キャリアの内側ラッチ
2	CPU	5	TIM ブレーカー スロットに差し込まれ ている No.1 マイナス ドライバ
3	CPUキャリアのTIM BREAKER スロット	-	

- b) TIM ブレーカー スロットに最も近い位置にある CPU キャリア クリップをつまんでから押し上げ、 ヒートシンクの隅のスロットからクリップを外します。
- c) TIM BREAKER と印字されているスロットに、#1 マイナス ドライバの先端を差し込みます。
 - (注) 次のステップでは、CPUの表面を押し開けないでください。ゆっくりと回転させ、TIM ブレーカースロットの位置でCPUキャリアのプラスチック面を持ち上げます。ヒートシンク表面の損傷を防ぐため、十分注意してください。
- d) ドライバをゆっくりと回転させ、ヒートシンクの TIM が CPU から離れるまで、CPU を持ち上げま す。
 - (注) ドライバの先端で緑色の CPU 基盤に触ったり、損傷したりしないようにしてください。
- e) TIM ブレーカーの反対側の隅にある CPU キャリア クリップをつまんで押し上げ、ヒートシンクの隅のスロットからクリップを外します。

- f) CPUキャリアの残りの2つの隅で、外側ラッチをゆっくりと外側に押し開け、ヒートシンクからCPU アセンブリを持ち上げます。
 - (注) CPUアセンブリを取り扱うときには、プラスチック製のキャリアだけをつかんでください。 CPUの表面には触れないでください。プラスチック製のキャリアから CPUを外さないでく ださい。
- **ステップ5** 新しい CPU アセンブリは、CPU アセンブリ ツールに入った状態で出荷されます。新しい CPU アセンブ リと CPU アセンブリ ツールを箱から取り出します。

CPU アセンブリと CPU アセンブリ ツールを分離した場合は、正しい向きになるよう次の図に示す位置 合わせ機能に注意してください。CPU キャリアのピン1の三角形を、CPU アセンブリ ツールの斜めに なった角に合わせる必要があります。

注意 CPU とそのソケットは壊れやすいので、ピンを損傷しないように十分に注意して扱う必要があります。

図 36: CPU アセンブリ ツール、CPU アセンブリ、ヒートシンク位置合わせ機構



1	CPU アセンブリ ツール	4	ヒートシンクの斜めになった角(ピン1 位置合わせ機構)
2	CPU アセンブリ(プラスチック製キャ リア フレーム内の CPU)	5	プラスチック製キャリアの三角形の切り 込み(ピン1位置合わせ機構)
3	ヒートシンク	6	CPU アセンブリツールの斜めになった角 (ピン1位置合わせ機構)

- **ステップ6**新しい TIM をヒートシンクに塗布します。
 - (注) 適切に冷却されてパフォーマンスが出るように、ヒートシンクの CPU 側の表面に新しい TIM が必要です。
 - 新しいヒートシンクを取り付ける場合は、新しいヒートシンクにはTIM が塗布されたパットが付属しています。ステップ5に進みます。
 - ・ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクから古い TIM を除去してから、付属のシリンジから新しい TIM を CPU 表面に塗布する必要があります。次のステップ a に進みます。
 - a) ヒートシンクの古い TIM に、ヒートシンク クリーニング キット(UCSX-HSCK=) 付属の洗浄液を 塗布し、少なくとも 15 秒間吸収させます。
 - b) ヒートシンク クリーニング キット付属の柔らかい布を使って、古い CPU から TIM をすべてふき取 ります。ヒートシンク表面に傷を付けないように注意してください。
 - c) 新しい CPU (UCS-CPU-TIM=) 付属の TIM のシリンジを使用して、4 立方センチメートルのサーマ ルインターフェイスマテリアルを CPU の上部に塗布します。均一に塗布されるように、次に示すパ ターンを使用してください。

図 37: サーマル インターフェイス マテリアルの塗布パターン



- ステップ7 CPU アセンブリ ツールに CPU アセンブリが配置されている状態で、ヒートシンクを CPU アセンブリに 設置します。正しい向きになるように、ピン1の位置合わせ機構に注意してください。CPU キャリアの 隅のクリップがヒートシンクの隅にはまるときのカチッという音が聞こえるまで、ゆっくりと押し下げ ます。
 - **注意** 次のステップでは、CPU コンタクトや CPU ソケット ピンに触れたり損傷したりすることがな いように、十分注意してください。

- **ステップ8** CPU/ヒートシンクアセンブリをサーバに取り付けます。
 - a) CPUアセンブリツールから、ヒートシンクと、ヒートシンクに取り付けられている CPUアセンブリ を持ち上げます。
 - b) 次の図に示すように、ボードの CPU ソケットの上でアセンブリに合わせます。

位置合わせ機構に注意してください。ヒートシンクのピン1の斜めになった角が、CPU ソケットの ピン1の斜めになった角と合っている必要があります。CPU ソケットの支柱が、アセンブリのガイ ド穴の位置に合っている必要があります。

図 38: CPU ソケットへのヒートシンク/CPU アセンブリの取り付け



1	アセンブリのガイド穴(2 個)	4	ヒートシンクの斜めになった角(ピン 1 位置合わせ機構)
2	CPU ソケットの位置合わせ支柱(2 個)	5	ソケットの斜めになった角(ピン1位 置合わせ機構)
3	CPU ソケット リーフ スプリング	-	

c) CPU アセンブリとヒートシンクを CPU ソケットに配置します。

- d) 交換用 CPU に付属している T-30 トルク ドライバを使用して、ヒートシンクをマザーボードのスタ ンドオフに固定する 4 つの非脱落型ナットを締めます。
 - (注) ヒートシンクを水平に下ろすため、ヒートシンクナットを交互に均等に締めます。ヒートシンクナットを、ヒートシンクラベルに示されている順序(1、2、3、4)で締めます。
 CPU ソケットのリーフスプリングが平らになるように、非脱落型ナットを完全に締める必要があります。
- ステップ9 CPU モジュールをシャーシに戻します。
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーンコネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モジュールをベイに押し込みます。
 - c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェクトレバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ10** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ11** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
 - (注) CPU モジュールの前面の電源 LED が緑色に点灯していることを確認します。

RMA 交換 CPU の注文に追加する CPU 関連部品

CPU の返品許可(RMA)が Cisco UCS C シリーズ サーバで行われた場合は、追加部品が CPU のスペアに含まれていないことがあります。TAC エンジニアが正常に交換を行うためには、 RMA に追加部品を追加する必要がある場合があります。



- (注) 新しいCPUモジュールに既存のCPUを移動する場合は、CPUとヒートシンクを分離する必要 はありません。これらは、1つのアセンブリとして移動できます。IOモジュールのRMA交換 で注文する、追加のCPU関連パーツ(87ページ)を参照してください。
 - シナリオ1:既存のヒートシンクを再利用しています。
 - ・ヒートシンクのクリーニングキット(UCSX-HSCK=)
 - 1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。
 - M5 サーバ用サーマル インターフェイス マテリアル (TIM) キット (UCS CPUTIM =)
 - 1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。
 - ・シナリオ2:既存のヒートシンクを交換しています。
 - ・ヒートシンク (UCSC-HS-02-EX=)

新しいヒートシンクには、TIM が事前に塗布されたパッドが付いています。

・ヒートシンクのクリーニングキット(UCSX-HSCK=)

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

- ・シナリオ 3: CPU キャリア(CPU の周りのプラスチック フレーム)が破損しています。
 - ・CPU キャリア: UCS-M5-CPU-CAR=
 - ・#1 マイナス ドライバ (ヒートシンクからの CPU の分離に使用)
 - ・ヒートシンク クリーニング キット (UCSX-HSCK=)

1つのクリーニングキットで最大4つの CPU をクリーンアップできます。

• M5 サーバ用サーマルインターフェイス マテリアル (TIM) キット (UCS CPUTIM =)

1つの TIM キットが1つの CPU をカバーします。

CPU ヒートシンク クリーニング キットは最大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに最 適です。クリーニング キットには、古い TIM の CPU およびヒートシンクのクリーニング用 と、ヒートシンクの表面調整用の 2 本のボトルの溶液が入っています。

新しいヒートシンクのスペアには、TIMのパッドが貼り付けられています。ヒートシンクを取り付ける前に CPU の古い TIM を洗浄することが重要です。このため、新しいヒート シンクを 注文する場合でも、ヒート シンク クリーニング キットを注文する必要があります。

IO モジュールの RMA 交換で注文する、追加の CPU 関連パーツ

IO モジュールの返品許可(RMA)は、C480 M5 CPU モジュールで行った場合は、既存の CPU を新しい CPU に移動します。



- (注) 前世代の CPU とは異なり、M5 サーバの CPU では CPU ヒートシンク アセンブリを移動する際
 に CPU からヒートシンクを分離する必要がありません。したがって、ヒートシンク クリーニング キットやサーマル インターフェイス マテリアルの品目を追加する必要はありません。
 - CPU またはヒートシンク アセンブリの移動に必要なツールは T-30 トルクス ドライバのみ です。

CPU を新しい CPU モジュールにに移動するには、M5 世代 CPU の移動 (87 ページ) の手順 を使用します。

M5 世代 CPU の移動

この手順に必要なツール: T-30 トルクス ドライバ

Â

- 注意 RMAにより発送される交換用サーバでは、すべてのCPUソケットにダストカバーが装着され ています。カバーは輸送中にソケットのピンを損傷から保護します。以下の手順で説明するよ うに、返品するシステムにこれらのカバーを移動させる必要があります。
- ステップ1 M5 CPU を新しいサーバに移動する場合、CPU からヒートシンクを分離する必要はありません。次の操作 を行ってください。
 - a) T-30 トルクス ドライバを使用して、ボードのスタンドオフにアセンブリを固定している 4 本のキャプ ティブ ナットを緩めます。
 - (注) ヒートシンクを水平に持ち上げるため、ヒートシンクナットを交互に均等に緩めます。ヒー トシンクナットを、ヒートシンクラベルに示されている順序(4、3、2、1)で緩めます。
 - b) CPUとヒートシンクのアセンブリをまっすぐに持ち上げて、ボードから取り外します。
 - c) ヒートシンクを外して CPU を静電気防止シートの上に置きます。

図 39: CPU/ヒートシンク アセンブリの取り外し



1	ヒートシンク	4	マザーボード上の CPU ソケット
2	ヒートシンクの非脱落型ナット(各側 に2個)	5	T-30 トルク ドライバ
3	CPUキャリア(この図ではヒートシン クの下)	-	

- ステップ2 新しいシステムから返品するシステムに CPU ソケット カバーを移動させます。
 - a) ソケットカバーを交換用システムから取り外します。「REMOVE」マークが付けられた2個のくぼみ をつかみ、真っ直ぐに持ち上げます。
 - (注) カバーの両端のくぼみをしっかりとつかんでください。CPU ソケットのピンに触れないでく ださい。

図 40: CPU ソケット ダスト カバーの取り外し



- b) ダストカバーの文字が書かれた面を上にして、CPUソケットの上に装着します。カバーの穴開き部分 がソケット プレート上のすべての位置合わせ支柱に合っていることを確認します。
 - **注意** 次の手順で記述されている2ヵ所以外、カバー上のどこも押さないでください。他の場所を 押すとソケットのピンが損傷する危険性があります。
- c) 2 つのネジ式支柱の近くにある「INSTALL」の横の2 つの丸いマークを押し下げます(次の図を参照)。カチッという音が聞こえ、装着された感触がするまで押します。
 - (注) 輸送中にダストカバーが緩まないようにするため、カチッという音と感触がするまで押す必要があります。





-	INSTALLの横にある2つの丸いマーク	-	
	を押します。		

ステップ3 新しいシステムに CPU を取り付けます。

a) 新しいボード上で、次に示すように、CPU ソケット上にアセンブリの位置を合わせます。

位置合わせ機構に注意してください。ヒートシンクのピン1の斜めになった角が、CPU ソケットのピン1の斜めになった角と合っている必要があります。CPU ソケットの支柱が、アセンブリのガイド穴の位置に合っている必要があります。



図 42: CPU ソケットへのヒートシンク/CPU アセンブリの取り付け

1	アセンブリのガイド穴(2 個)	4	ヒートシンクの斜めになった角(ピン1 位置合わせ機構)
2	CPU ソケットの位置合わせ支柱(2 個)	5	ソケットの斜めになった角(ピン1位置 合わせ機構)
3	CPU ソケット リーフ スプリング	-	

- b) 新しいボード上で、CPU とヒートシンクのアセンブリを CPU ソケットに配置します。
- c) T-30 トルクス ドライバを使用して、ヒートシンクをボードのスタンドオフに固定する 4 本のキャプ ティブ ナットを締め付けます。
 - (注) ヒートシンクを水平に下ろすため、ヒートシンクナットを交互に均等に締めます。ヒートシンクナットを、ヒートシンクラベルに示されている順序(1、2、3、4)で締めます。CPUソケットのリーフスプリングが平らになるように、非脱落型ナットを完全に締める必要があります。

メモリ(DIMM)の交換

▲
 注意 DIMM とそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要 があります。
 ▲
 注意 シスコではサードパーティの DIMM はサポートしていません。シスコ以外の DIMM をサーバ で使用すると、システムに問題が生じたり、マザーボードが損傷したりすることがあります。

(注) サーバ パフォーマンスを最大限に引き出すには、DIMM の取り付けまたは交換を行う前に、 メモリ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

DIMM の装着規則とメモリ パフォーマンスに関するガイドライン

ここでは、最大のメモリパフォーマンスを得るためのルールおよびガイドラインについて説明 します。

(注) 十分なエアーフローがあることを確認し、DIMM がない DIMM スロットに DIMM ブランキン グパネルを使用する必要があります。

DIMM スロットの番号付け

次の図では、CPUモジュールボード上のDIMMスロットの番号付けを示します。CPUモジュー ルがベイ1(下部ベイ)にあるとき、システムはCPUをCPU1とCPU2として番号付けしま す。CPUモジュールがベイ2(上部ベイ)にあるとき、システムはCPUをCPU3とCPU4と して番号付けします。

図 43: DIMM スロットの番号付け



DIMM 装着ルール

最大のパフォーマンスを得るために、DIMMの取り付けまたは交換を行うときは、次のガイド ラインに従ってください。

- •各 CPU では6つのメモリ チャネルがサポートされます。
 - CPU 1/3 はチャネル A、B、C、D、E、Fをサポートします。
 - CPU 2/4 はチャネル G、H、J、K、L、M をサポートします。
- ・各チャネルには DIMM スロットが 2 つあります(たとえば、チャネル A=スロット A1 と A2)。
- ・最適なパフォーマンスを得るには、CPU あたりの DIMM の数に応じて、次の表に示す順 序で DIMM を装着します。2 つの CPU で表に示すように全体に均等に DIMM のバランス を取ります。



(注) 次の表に、推奨構成を示します。CPU あたり 5、5、7、9、10、または 11 DIMM を使用することはお勧めしません。



 (注) 下部 CPU モジュール1の CPU 番号は、上部 CPU モジュール2の CPU1および CPU2であり、システムでは CPUを CPU3および CPU4として番号助します。チャネルの文字は、CPUの両方のモジュールで同じです。存在する場合、4台すべての CPUで DIMM のバランスを均等にとります。

表 6: DIMM 装着順序

CPU あたりの DIMM の数(推	CPU1またはCP プ	U3スロットの入 り	CPU 2 または CPU 4 スロットの入 カ		
() 笑情成 <i>)</i>	青の#1 スロット	黒の#2 スロット	青の#1 スロット	黒の#2スロット	
1	(A1)	-	(G1)	-	
2	(A1、B1)	-	(G1、H1)	-	
3	(A1, B1, C1)	-	(G1、H1、J1)	-	
4	(A1、B1) 、 (D1、E1)	-	(G1、H1) 、 (K1、L1)	-	
8	(A1、B1) 、 (D1、E1)	(A2、B2) (D2、E2)	(G1、H1) 、 (K1、L1)	(G2、H2) (K2、L2)	

12	(A1、B1) 、	(A2、B2) 、	(G1、H1) 、	(G2、H2) 、
	(C1、D1) 、	(C2、D2) 、	(J1、K1) 、	(J2、K2) 、
	(E1、F1)	(E2、F2)	(L1、M1)	(L2、M2)

- •1 つの CPU によって制御される 12 個の DIMM スロットで使用できる最大合計メモリ容量 は 768 GB です。12 個の DIMM スロットに合計 768 GB を超える容量のメモリを装着する には、「M」で終わる PID を持つ大容量メモリ CPU(たとえば、UCS-CPU-6134 M)を使 用する必要があります。
- すべての DIMM は ECC をサポートしている DDR4 DIMM である必要があります。非 UDIMMおよび非 ECC DIMM はサポートされていません。
- ・メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が50%減少します。メモリのミラーリングを有効にしている場合は、偶数番号のチャネルに DIMM を装着する必要があります。
- NVIDIA M シリーズ GPU は、サーバで1 TB 未満のメモリのみサポートします。
- NVIDIA P シリーズ GPU は、サーバで 1 TB 以上のメモリがさらにサポートできます。
- ・AMD FirePro S7150 X2 GPU は、サーバで1 TB 以下のメモリのみサポートします。
- ・次の表に示す DIMM の混在規則に従ってください。

表 7: DIMM の混在使用の規則

DIMM パラメータ	同一チャネル内の DIMM	同ーバンク内の DIMM
DIMM 容量 例:16 GB、32 GB、64 GB、128 GB	同一チャネル内に異なる容量 の DIMM を混在させることが できます(たとえば、A1、A2 など)。	バンク内で DIMM 容量を混在させ ることはできません(たとえば、 A1、B1)。DIMM のペアは同じで ある必要があります(同じ PID およ びリビジョン)。
DIMM 速度 例:2666 GHz	速度を混在できますが、DIMM はチャネルにインストールさ れた最も遅い DIMM/CPU の速 度で動作します。	バンク内で DIMM 速度を混在させ ることはできません(たとえば、 A1、B1)。DIMM のペアは同じで ある必要があります(同じ PID およ びリビジョン)。
DIMM タイプ RDIMM または LRDIMM	チャネル内で DIMM タイプを 混在させることはできません。	バンク内で DIMM タイプを混在さ せることはできません。

メモリのミラーリング

サーバ内の Intel CPU は、偶数個のチャネルに DIMM を装着した場合にのみ、メモリのミラー リングをサポートします。1つのチャネルまたは3つのチャネルに DIMM を装着した場合、メ モリのミラーリングは自動的に無効になります。

メモリのミラーリングを使用すると、2つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供されないため、使用可能なメモリ量が 50%減少します。また、重複するチャネルは冗長性を提供します。

DIMM の交換

障害のある DIMM の識別

各 DIMM ソケットには、対応する DIMM 障害 LED が DIMM ソケットの正面にあります。こ れらの LED の位置については、内部診断 LED (6ページ) を参照してください。

ステップ1 注意 シャット ダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPU モジュールを削除しないでください。

次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) CPUモジュールはサーバの前面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。
- ステップ2 シャーシから 既存の CPU モジュールを取り外します:
 - (注) モジュールを取り外す前に、CPU モジュールの前面の電源 LED がオフあることを確認します。
 - a) CPU モジュール前面の2本のイジェクトレバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外し ます。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- ステップ3 CPU モジュールから既存の DIMM(または空白 DIMM)を取り外します。

a) 取り外す DIMM の場所を確認して、その DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。

- ステップ4 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。
 - (注) DIMMを装着する前に、このサーバのメモリ装着規則(DIMMの装着規則とメモリパフォーマン スに関するガイドライン(93ページ))を参照してください。
 - (注) 十分な空気循環があることを確認し、DIMM がない DIMM スロットに DIMM ブランキング パネ ルを使用する必要があります。
 - a) 新しい DIMM を CPU モジュール ボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロット内の 位置合わせ機能を使用して、DIMM を正しい向きに配置します。

b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクトレバーが所定の位置にロックされるまで、DIMM の 上部の角を均等に押し下げます。

ステップ5 CPU モジュールをシャーシに戻します。

- a) 2 つのイジェクトレバーを開き、CPUモジュールを空のベイの位置に合わせます。
- b) モジュールがミッドプレーンコネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モ ジュールをベイに押し込みます。
- c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェ クトレバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ1 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
 - (注) CPU モジュールの前面の電源 LED が緑色に点灯していることを確認します。

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールの交換

このトピックには、Intel Optane データセンター永続メモリモジュール(DCPMM)を交換する ための情報(検証機能のための装着規則と方法を含む)が含まれています。DCPMMはDDR4 DIMMと同じフォームファクタを持ち、DIMM スロットに取り付けます。

Â

注意 DCPMMとそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要があります。



(注) サーバパフォーマンスを最大限に引き出すには、DCPMMの取り付けまたは交換を行う前に、 メモリパフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

(注) Intel Optane DC 永続メモリ モジュールには、第二世代 Intel Xeon Scalable processors が必要で す。DCPMM をインストールする前に、サーバのファームウェアと BIOS をバージョン 4.0 (4) 以降にアップグレードしてから、サポートされている第二世代 Intel Xeon Scalable processors を インストールする必要があります。

DCPMMは、次の3つのモードのいずれかで動作するように設定できます。

・メモリモード(デフォルト):モジュールは100%メモリモジュールとして動作します。
 データは揮発性であり、DRAMはDCPMMのキャッシュとして機能します。これは工場
 出荷時のデフォルトモードです。

- アプリダイレクトモード:モジュールは、ソリッドステートディスクストレージデバイスとして動作します。データは保存され、不揮発性です。
- ・混合モード(25%メモリモード+75%アプリダイレクト):このモジュールでは、25%の容量を揮発性メモリとして使用し、75%の容量を不揮発性ストレージとして使用して動作します。

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールの丹生直規則とパフォーマンスのガイドライン

このトピックでは、DDR4DIMMを使用したIntel Optane DC 永続メモリモジュール(DCPMM) を使用する場合の、メモリパフォーマンスの最大値に関する規則とガイドラインについて説明 します。

DIMM スロットの番号付け

次の図では、CPUモジュールボード上のDIMMスロットの番号付けを示します。CPUモジュー ルがベイ1(下部ベイ)にあるとき、システムはCPUをCPU1とCPU2として番号付けしま す。CPUモジュールがベイ2(上部ベイ)にあるとき、システムはCPUをCPU3とCPU4と して番号付けします。

図 44: DIMM スロットの番号付け



設定ルール

次の規則とガイドラインを確認してください。

- ・このサーバで DCPMM を使用するには、4 個の CPU を取り付ける必要があります。
- Intel Optane DC 永続メモリ モジュールには、第二世代 Intel Xeon Scalable processors が必要です。DCPMM をインストールする前に、サーバのファームウェアと BIOS をバージョン4.0 (4) 以降にアップグレードしてから、サポートされている第二世代 Intel Xeon Scalable processors をインストールする必要があります。
- ・サーバで DCPMM を使用する場合:
 - サーバにインストールされているDDR4DIMMは、すべて同じサイズである必要があります。
 - ・サーバにインストールされている DCPMM はすべて同じサイズである必要があり、同じ SKU が必要です。

- DCPMM は 2666 MHz で動作します。サーバに 2933 MHz RDIMM または LRDIMM があり、DCPMM を追加すると、メインメモリの速度は 2666 MHz に下がり、DCPMM の速度に一致します。
- •各 DCPMM は、20 W をピークとして 18 W を引き出します。
- 次の表は、このサーバでサポートされる DCPMM 設定を示しています。示されているように、DCPMM: DRAMの比率に応じて、CPUモジュールの CPU1と CPU2に DIMM スロットを装着します。CPUモジュール2がある場合は、示されているように CPU3 および CPU4の DIMM スロットに入力します。

図 45: クアッド CPU 設定用のサポートされる DCPMM 構成

DIMM to DCPMM Count		CPU 1 (lower server node)											
		IMC1						IMC0					
	Chan	Channel 2 Channel 1		nel 1	Channel 0		Channel 2		Channel 1		Channel 0		
	F2	F1	E2	E1	D2	D1	C2	C1	B2	B1	A2	A1	
6 to 2		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM	
6 to 4		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	
6 to 6	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	

DIMM to DCPMM Count		CPU 2 (lower server node)										
			IM	C1			IMC0					
Channel 2		Chan	Channel 1 Ch		hannel 0 Chan		nel 2 Chann		inel 1 Char		nnel O	
	M2	M1	L2	L1	K2	K1	J2	JI	H2	H1	G2	G1
6 to 2		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 4		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 6	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM

DIMM to DCPMM Count		CPU 3 (upper server node)										
			IM	C1			IMC0					
	Channel 2		Channel 1 Chann		nel O	Channel 2		Channel 1		Channel 0		
	F2	F1	E2	E1	D2	D1	C2	C1	B2	B1	A2	A1
6 to 2		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 4		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 6	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM

DIMM to DCPMM Count		CPU 4 (upper server node)										
		IMC1 IMC0										
	Channel 2		Chan	nel 1	el 1 Channel 0		Channel 2		Channel 1		Channel 0	
	M2	M1	L2	L1	K2	К1	J2	J1	H2	H1	G2	G1
6 to 2		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 4		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM		DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM
6 to 6	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM	DCPMM	DIMM

Intel Optane DC 永続メモリ モジュールのインストール

- (注) DCPMM 設定は、交換用 DCPMM を含む、領域内のすべての DCPMM に常に適用されます。 事前設定されたサーバでは、特定の交換用 DCPMM をプロビジョニングすることはできません。
- **ステップ1 注意** シャット ダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPU モジュールを削除しないでください。

次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) CPUモジュールはサーバの前面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。
- **ステップ2** シャーシから 既存の CPU モジュールを取り外します:
 - (注) モジュールを取り外す前に、CPU モジュールの前面の電源 LED がオフあることを確認します。
 - a) CPU モジュール前面の2本のイジェクト レバーを持ってラッチをつまみ、レバーを開放します。
 - b) 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして取り外し ます。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- **ステップ3** 既存の DCPMM の削除:
 - 注意 RMA 状況のように、あるサーバから別のサーバに DCPMM をアクティブ データ(永続メモリ) とともに移動する場合は、各 DCPMM を新しいサーバの同じ位置にインストールする必要があり ます。古いサーバから削除するときに、各 DCPMM の位置を書き留めたり、一時的にラベルを付 けたりします。
 - a) 取り外す DCPMM の場所を確認して、その DIMM スロットの両端のイジェクト レバーを開きます。
 - b) DCPMM をまっすぐ持ち上げ、横に置きます。
- ステップ4 新しい DCPMM をインストールします。
 - (注) DCPMM を装着する前に、このサーバの装着規則(Intel Optane DC 永続メモリ モジュールの丹生 直規則とパフォーマンスのガイドライン (98 ページ))を参照してください。
 - a) 新しい DCPMM をマザーボード上の空のスロットの位置に合わせます。DIMM スロット内の位置合わ せ機能を使用して、DCPMM を正しい向きに配置します。
 - b) DIMM がしっかりと装着され、両端のイジェクト レバーが所定の位置にロックされるまで、DCPMM の上部の角を均等に押し下げます。

- ステップ5 CPUモジュールをシャーシに戻します。
 - a) 2 つのイジェクト レバーを開き、CPU モジュールを空のベイの位置に合わせます。
 - b) モジュールがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシの前面と同じ高さになる位置まで、モ ジュールをベイに押し込みます。
 - c) 両方のイジェクトレバーが平らになり、ラッチがモジュールの前面にロックされるまで、両方のイジェ クトレバーを中央に向けて回転させます。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ1 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。
 - (注) CPU モジュールの前面の電源 LED が緑色に点灯していることを確認します。
- ステップ8 インストール後の操作を実行します。
 - ・既存の設定が100%メモリモードで、新しいDCPMMも100%メモリモード(工場出荷時のデフォルト)の場合、操作はすべてのDCPMMが最新の一致するファームウェアレベルであることを確認することだけです。
 - 既存の設定が完全にまたは一部 App-Direct モードで、新しい DCPMM も App-Direct モードの場合、すべての DCPMM が最新の一致するファームウェア レベルであることを確認し、新しい目標を作成することによって DCPMM の再プロビジョニングも行います。
 - 既存の設定と新しい DCPMM が異なるモードの場合は、すべての DCPMM が最新の一致するファーム ウェア レベルであることを確認し、新しい目標を作成することによって DCPMM の再プロビジョニン グも行います。
 - 目標、地域、および名前空間を設定するためのツールが多数用意されています。
 - ・サーバのBIOSセットアップユーティリティを使用するには、『DCPMMのサーバーBIOSセットアップユーティリティメニュー (101ページ)』を参照してください。
 - Cisco IMC または Cisco UCS Manager を使用するには、『Cisco UCS: Intel Optane DC 永続メモリモジュールの設定と管理』ガイドを参照してください。

DCPMM のサーバー BIOS セットアップ ユーティリティ メニュー

∕!∖

注意 データ損失の可能性:現在インストールされている DCPMM のモードを、アプリ ダイレクト モードまたは混合モードからメモリモードに変更すると、永続メモリ内のデータはすべて削除 されます。

DCPMM は、サーバの BIOS セットアップ ユーティリティ、Cisco IMC、Cisco UCS Manager、 または OS 関連のユーティリティを使用して設定できます。

- BIOS セットアップユーティリティを使用するには、以下のセクションを参照してください。
- Cisco IMC を使用するには、Cisco IMC 4.0(4) 以降の設定ガイドを参照してください。CISCO IMC CLI および GUI 設定ガイド
- Cisco UCS Manager を使用するには、Cisco UCS Manager 4.0(4) 以降の設定ガイドを参照してください。Cisco UCS Manager CLI および GUI 設定ガイド

サーバー BIOS セットアップ ユーティリティには、DCPMM のメニューが含まれています。 DCPMM の領域、目標、および名前スペースを表示または設定したり、DCPMM ファームウェ アを更新したりするために使用できます。

システム ブート中ににプロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップ ユーティ リティを開きます。

DCPMM メニューは、ユーティリティの [詳細] タブにあります。

Advanced > Intel Optane DC Persistent Memory Configuration

このタブから、他のメニュー項目にアクセスできます。

- DIMM: インストールされている DCPMM を表示します。このページから、DCPMM ファームウェアを更新し、他の DCPMM パラメータを設定できます。
 - ・ヘルスのモニタ
 - •ファームウェアの更新
 - セキュリティの設定

セキュリティモードを有効にして、DCPMM設定がロックされるようにパスワードを 設定することができます。パスワードを設定すると、インストールしたすべての DCPMMに適用されます。セキュリティモードはデフォルトでは無効です。

- ・データ ポリシーの設定
- •領域:領域とその永続的なメモリタイプを表示します。インターリーブでアプリダイレクトモードを使用する場合、リージョンの数はサーバ内の CPU ソケットの数に等しくなります。インターリーブでアプリダイレクトモードを使用しない場合、リージョンの数はサーバ内の DCPMM ソケットの数に等しくなります。

[領域]ページから、リソースの割り当て方法をDCPMMに通知するメモリの目標を設定できます。

目標設定の作成

・名前スペース:名前スペースを表示し、永続的なメモリが使用されているときにそれらを作成または削除することができます。目標の作成時に名前スペースを作成することもできます。永続メモリの名前スペースのプロビジョニングは、選択した領域にのみ適用されます。

サイズなどの既存の名前スペース属性は変更できません。名前スペースを追加または削除 することができます。
 ・
 合計容量:
 ・
 サーバ全体のリソース割り当ての合計を表示します。

BIOS セットアップユーティリティを使用して DCPMM ファームウェアを更新する

.binファイルへのパスがわかっている場合は、BIOSセットアップユーティリティからDCPMM ファームウェアを更新できます。ファームウェアの更新は、インストールされているすべての DCPMM に適用されます。

- [Advanced (詳細)] > [Intel Optane DC Persistent Memory Configuration (Intel Optane DC 永続メモリ設定)] > [DIMM] > [Update firmware (ファームウェアの更新)] に移動します。
- 2. [File (ファイル)] で、ファイルパスを.bin ファイルに指定します。
- 3. [アップデート (Update)]を選択します。

I/O モジュール内のコンポーネントの交換



RTCバッテリの交換

ĥ

警告 バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。Replace the battery only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

ステートメント 1015

リアルタイムクロック(RTC)バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定 を保持します。バッテリタイプはCR2032です。シスコでは、シスコに注文でき(PID N20-MBLIBATT)、ほとんどの電器店からも購入できる、業界標準のCR2032バッテリをサ ポートしています。

∕!∖

注意 シャットダウンおよびサーバから電源を取り外さないでI/Oモジュールを削除しないでください。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) I/Oモジュールはサーバの背面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。
- ステップ2 シャーシから I/O モジュールを取り外します:
 - a) I/O モジュールのポートからすべてのケーブルを外します。
 - b) I/Oモジュールのイジェクト処理のロッククリップを下に押してプ、ハンドルを上に動かしてシャーシ のミッド プレーンからモジュールのコネクタを外します。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- ステップ3 RTC バッテリを取り外します。
 - a) I/O モジュール ボード上の垂直 RTC バッテリ ソケットを探します。
 - b) ソケットからバッテリを取り外します。保護クリップをゆっくりと押し開けて隙間を確保し、バッテ リを持ち上げます。
- ステップ4 新しい RTC バッテリを取り付けます。
 - a) バッテリをソケットに挿入し、カチッという音がするまでクリップの下に押し込みます。
 - (注) 「3V+」とマークされているバッテリの上の平面は、ソケットのクリップと面している必要 があります(モジュールの背面に対して)。





ステップ5 I/O モジュールをシャーシに戻します。

- a) イジェクト処理を開き、I/Oモジュールを空のベイの位置を合わせます。
- b) ミッドプレーン コネクタとかみ合う位置まで、モジュールをベイに押し込みます。
- c) 平面まで達しロック クリップがかみ合うまでイジェクト処理のを下に動かします。モジュール面は シャーシの背面パネルと同じ高さになる必要があります。
- d) I/O モジュールのポートにケーブルを再接続します。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ1** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

microSD カードの交換

I/O モジュール ボードに、Micro SD カード用のソケットが1つあります。



注意 シャットダウンおよびサーバから電源を削除しないで、CPU モジュールを削除しないでくだ さい。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) I/Oモジュールはサーバの背面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。

ステップ2 シャーシから I/O モジュールを取り外します:

- a) I/O モジュールのポートからすべてのケーブルを外します。
- b) I/Oモジュールのイジェクト処理のロッククリップを下に押してプ、ハンドルを上に動かしてシャーシ のミッド プレーンからモジュールのコネクタを外します。
- c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- ステップ3 既存の microSD カードを取り外します。
 - a) microSD カードを確認します。
 - b) Micro SD カードを横方向に押してから離すと、ばねの作用でソケットから外すことができます。
 - c) microSD カードをつかみ、ソケットから持ち上げます。
- ステップ4 新しい microSD カードを装着します。
 - a) ソケットと新しい Micro SD カードの位置を合わせます。
 - b) カチッと音がしてソケットの所定の位置にロックされるまで、カードをゆっくりと押し下げます。

図 47: I/O モジュール内部 Micro SD カードの場所



1	I/O モジュール ボードの Micro SD カー	-	
	ド ソケットの場所		

- ステップ5 I/O モジュールをシャーシに戻します。
 - a) イジェクト処理を開き、I/O モジュールを空のベイの位置を合わせます。
 - b) ミッドプレーン コネクタとかみ合う位置まで、モジュールをベイに押し込みます。
 - c) 平面まで達しロック クリップがかみ合うまでイジェクト処理のを下に動かします。モジュール面は シャーシの背面パネルと同じ高さになる必要があります。
 - d) I/O モジュールのポートにケーブルを再接続します。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ1 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

ミニストレージ モジュールの交換

ミニストレージモジュールを I/O モジュール ボード ソケットに差し込むことにより、内部ストレージを追加します。ミニストレージモジュールには、2 種類のバージョンがあります。

•SD カードキャリア:2つのSD カードソケットを提供します。

・M.2 SSD キャリア: 2 つの M.2 フォームファクタ SSD ソケットを提供します。



(注) Cisco IMC ファームウェアには、このミニストレージモジュールの M.2 バージョンにインストールされている M.2 ドライブのアウトオブバンド管理インターフェイス(UCS-MSTOR-M2)は含まれていません。M.2 ドライブは、Cisco IMCインベントリには表示されず、Cisco IMCによって管理することもできません。これは想定されている動作です。

ミニストレージ モジュール キャリアの交換

ここでは、ミニストレージモジュールキャリアの取り外しと取り付けについて説明します。 キャリアには、上部に1つのメディアソケット、下部に1つのソケットがあります。すべての タイプ (SD カードまたは M.2 SSD)のミニストレージモジュールキャリアに対して、次の手 順を使用します。

Â

- 注意 シャットダウンおよびサーバから電源を取り外さないでI/Oモジュールを削除しないでください。
- ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。
 - a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) I/Oモジュールはサーバの背面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。
- **ステップ2** シャーシから I/O モジュールを取り外します:
 - a) I/O モジュールのポートからすべてのケーブルを外します。
 - b) I/Oモジュールのイジェクト処理のロッククリップを下に押してプ、ハンドルを上に動かしてシャーシのミッドプレーンからモジュールのコネクタを外します。
 - c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。
- ステップ3 ソケットからキャリアを取り外します。
 - a) ミニストレージモジュールキャリアを探します。
 - b) キャリアの両端を固定している保護クリップを外側に押します。
 - c) キャリアの両端を持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
 - d) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。
- ステップ4 新規キャリアをソケットに取り付けます。
 - a) キャリアのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、キャリアをソケット上に置きます。2つの配置ペグは、キャリアの2つの穴と一致する必要があります。

- b) 端のクリップの下にあるソケットの反対側にキャリアの端をセットします。
- c) 2つのペグがキャリアの2つの穴を通過するように、キャリアのソケットの端をゆっくりと押し下げま す。
- d) 固定クリップが両端でカチッと音がしてロックされるまで、キャリアを押し下げます。



図 48:1/0 モジュール ボードのミニストレージ モジュールの場所

1	ボード上のソケットの場所	3	配置ペグ
2	固定クリップ	-	

- ステップ5 I/O モジュールをシャーシに戻します。
 - a) イジェクト処理を開き、I/O モジュールを空のベイの位置を合わせます。
 - b) ミッドプレーン コネクタとかみ合う位置まで、モジュールをベイに押し込みます。
 - c) 平面まで達しロック クリップがかみ合うまでイジェクト処理のを下に動かします。モジュール面は シャーシの背面パネルと同じ高さになる必要があります。
 - d) I/O モジュールのポートにケーブルを再接続します。
- **ステップ6** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ1 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

SD 用ミニストレージ キャリア内の SD カードの交換

このトピックでは、SD 用ミニストレージキャリア(UCS-MSTOR-SD)内の SD カードの取り 外しと取り付けについて説明します。キャリアには上側に1つの SD カードソケットがあり、 下側に1つのソケットがあります。

ミニストレージ SD カードの装着ルール
- キャリア内で1つまたは2つのSDカードを使用できます。
- Cisco IMC インターフェイスから、デュアル SD カードを RAID 1 アレイ内に設定できます。
- SD ソケット1 はキャリアの上側にあり、SD2 ソケット2 はキャリアの下側(キャリアの マザーボード コネクタと同じ側)にあります。

Æ

- 注意 シャットダウンおよびサーバから電源を取り外さないでI/Oモジュールを削除しないでください。
- ステップ1 サーバの電源をオフにして、ミニストレージモジュールキャリアを I/O モジュールから取り外します(ミ ニストレージモジュールキャリアの交換(107ページ)を参照)。
- ステップ2 SD カードを取り外します。
 - a) SD カードの上部を押してから放すと、ばねの作用でソケットから外すことができます。
 - b) SD カードをつかみ、ソケットから取り外します。
- ステップ3 新しい SD カードを取り付けます。
 - a) ラベル面を上に向けて(キャリアと反対側)、新しい SD カードをソケットに取り付けます。
 - b) カチッと音がするまで SD カードを上から押し込み、スロットの所定の位置に収めます。
- **ステップ4** ミニストレージ モジュール キャリアを I/O モジュールに戻して取り付けます(ミニストレージ モジュー ル キャリアの交換(107 ページ)を参照)。

M.2 用ミニストレージ キャリア内の M.2 SSD の交換

このトピックでは、M.2 用ミニストレージキャリア(UCS-MSTOR-M2)内の M.2 SATA また はの取り外しと取り付けについて説明します。キャリアには、上部に1つの M.2 SSD ソケッ ト、下部に1つのソケットがあります。

ミニストレージ内の M.2 SSD の装着規則

- キャリア内で1つまたは2つのM.2SSDを使用できます。
- •M.2 スロット1はキャリアの上部にあり、M.2 スロット2はキャリアの下部(キャリアの マザーボードコネクタと同じ側)にあります。



- ステップ1 サーバの電源をオフにして、ミニストレージモジュールキャリアをサーバから取り外します(ミニストレージモジュールキャリアの交換(107ページ)を参照)。
- ステップ2 M.2 SSD を取り外します。
 - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 SSD をキャリアに固定している1本のネジを取り外します。
 - b) M.2 SSD をつかみ、キャリアのソケットの反対側の端の上まで持ち上げます。
 - c) M.2 SSD をキャリアのソケットから取り外します。
- ステップ3 新しい M.2 SSD を取り付けます。
 - a) 下に向けて新しい M.2 SSD のコネクタ側を、ラベルが上を向いている状態でキャリアのソケットに差 し込みます。
 - b) M.2 SSD をキャリアに押し込みます。
 - c) M.2 SSD の終端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。

ステップ4 ミニストレージモジュールキャリアをサーバに取り付け、電源をオンにします(ミニストレージモジュー ルキャリアの交換(107ページ)を参照)。

ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールの交換

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ モジュールを、I/O モジュール ボード上のミニス トレージモジュール ソケットに接続します。2 台の SATA M.2 ドライブ用のスロットに加え、 RAID 1 アレイ内の SATA M.2 ドライブを制御可能な統合 6 Gbps SATA RAID コントローラを 搭載しています。

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラに関する考慮事項

次の考慮事項を確認します。

- このコントローラをサポートする Cisco IMC および Cisco UCS Manager の最小バージョン は 4.0 (4) 以降です。
- •このコントローラは、RAID1(単一ボリューム)とJBODモードをサポートします。



- (注) このコントローラモジュールを使用するとき、RAID 設定のため にサーバ組み込み SW MegaRAID コントローラを使用しないでく ださい。代わりに、次のインターフェイスを使用できます。
 - Cisco IMC 4.0(4a) 以降
 - •BIOS HII ユーティリティ、BIOS 4.0(4a) 以降
 - Cisco UCS Manager 4.0(4a) 以降 (UCS Manager 統合サーバ)
- ・スロット1(上部)のSATA M.2ドライブは、最初のSATA デバイスです。スロット2(裏
 (側)のSATA M.2ドライブは、2番目のSATA デバイスです。
 - ・ソフトウェアのコントローラ名は MSTOR です。
 - スロット1のドライブはドライブ253としてマッピングされます。スロット2のドラ イブはドライブ254としてマッピングされます。
- RAID を使用する場合は、両方の SATA M.2 ドライブが同じ容量であることをお勧めしま す。異なる容量を使用すると、ボリュームを作成する 2 つのドライブの容量が小さくな り、残りのドライブ スペースは使用できなくなります。

JBOD モードは、混合容量の SATA M.2 ドライブをサポートします。

ホットプラグの交換はサポートされていません。サーバの電源をオフにする必要があります。

- コントローラおよびインストールされているSATA M.2ドライブのモニタリングは、Cisco IMCおよびCisco UCS Manager を使用して行うことができます。また、UEFI HII、PMCLI、 XMLAPI、Redfish などの他のユーティリティを使用してモニタすることもできます。
- ・コントローラおよび個別ドライバのファームウェア更新:
 - スタンドアロンサーバでは、Cisco Host Upgrade Utility (HUU)を使用します。『HUU マニュアル』を参照してください。
 - Cisco UCS Manager に統合されたサーバについては、『Cisco UCS Manager ファーム ウェア管理ガイド』を参照してください。
- SATA M.2 ドライブは UEFI モードでのみ起動できます。レガシ ブート モードはサポート されていません。
- RAID ボリュームの一部であった単一の SATA M.2 ドライブを交換する場合、ユーザーが 設定をインポートするように求めるプロンプトが表示された後に、ボリュームの再構築が 自動的に開始します。ボリュームの両方のドライブを交換する場合は、RAID ボリューム を作成し、手動で任意の OS を再インストールする必要があります。
- •別のサーバから使用済みドライブにボリュームを作成する前に、ドライブのコンテンツを 消去することをお勧めします。サーバ BIOS の設定ユーティリティには、SATA セキュア 消去機能が搭載されています。
- ・サーバBIOSには、このコントローラに固有の設定ユーティリティが含まれており、RAID ボリュームの作成と削除、コントローラプロパティの表示、および物理ドライブの内容の 消去に使用できます。サーバの起動中にプロンプトが表示された場合は、F2を押してユー ティリティにアクセスします。次に、[Advanced (高度)]>[Cisco Boot Optimized M.2 RAID Controller (Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ)]に移動します。

Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラの交換

このトピックでは、Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラを取り外して交換する方法について説明します。コントローラボードの上部には1つの M.2 ソケット(スロット1)と、その下側に1つの M.2 ソケット(スロット2)があります。

ステップ1 次のようにして、サーバでコンポーネントを取り外す準備をします。

- a) サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断(8ページ)を 参照)。
 - (注) I/Oモジュールはサーバの背面からアクセス可能なため、ラックからサーバを引き出したり、 サーバのカバーを取り外す必要はありません。

ステップ2 シャーシから I/O モジュールを取り外します:

- a) I/O モジュールのポートからすべてのケーブルを外します。
- b) I/Oモジュールのイジェクト処理のロッククリップを下に押してプ、ハンドルを上に動かしてシャーシ のミッド プレーンからモジュールのコネクタを外します。

c) モジュールをシャーシから引いて取り出し、静電気防止用シートやマットの上に置きます。

ステップ3 ソケットからコントローラを取り外します。

- a) コントローラボードの両端で、キャリアを固定しているクリップを外側に押します。
- b) コントローラの両端を持ち上げ、マザーボードのソケットから外します。
- c) キャリアを静電気防止シートの上に置きます。

図 49: マザーボード上の Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ



1	I/O モジュール ボード上のソケットの場所	3	固定クリップ
2	配置ペグ	-	

- ステップ4 古いコントローラから交換用コントローラに SATA M.2 ドライブを変える場合は、交換用コントローラを 取り付ける前に、次の操作を行ってください。
 - (注) ドライブ上で以前設定されたボリュームとデータは、M.2 ドライブを新しいコントローラに変え るときに保持されます。システムは、ドライブにインストールされている既存の OS を起動しま す。
 - a) No.1 プラス ドライバを使用して、M.2 ドライブをキャリアに固定している1本のネジを取り外しま す。
 - b) キャリアのソケットから M.2 ドライブを持ち上げます。
 - c) 交換用 M.2 ドライブをコントローラ ボードのソケット上に置きます。
 - d) M.2ドライブを下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。M.2ドライブのラベル が上向きになっている必要があります。
 - e) M.2 ドライブをキャリアに押し込みます。
 - f) M.2 SSD の終端をキャリアに固定する1本のネジを取り付けます。
 - g) コントローラの電源を入れ、2番目の M.2 ドライブを取り付けます。



図 50: Cisco ブート最適化 M.2 RAID コントローラ (M.2 ドライブの取り付けの表示)

- ステップ5 マザーボード上のソケットにコントローラを取り付けます。
 - a) コントローラのコネクタを下向きにし、マザーボードのソケットと同じ端で、コントローラをソケット上に置きます。2つの配置ペグは、コントローラの2つの穴と一致する必要があります。
 - b) 2つのペグがコントローラの2つの穴を通過するように、コントローラのソケットの端をゆっくりと押 し下げます。
 - c) 固定クリップが両端でカチッと音がしてロックされるまで、コントローラを押し下げます。
- ステップ6 サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ1** サーバをラックの元の位置に戻し、ケーブルを再度接続したら、電源ボタンを押してサーバの電源を完全 に投入します。

サービス DIP スイッチ

このサーバには、特定のサービスと Cisco IMC のデバッグ機能を使用できる DIP スイッチ (SW1)のブロックが含まれています。次の図に示すように、シャーシのマザーボードにブ ロックがあります。

次の図に示すスイッチは、デフォルトで示されるようにオープン位置に表示されます。

図 51: シャーシのマザーボード上の DIP スイッチの場所



DIP スイッチの機能	ピン番号(オープン-クローズ)
代理 Cisco IMC のイメージから起動します。	8~9
Cisco IMC を工場出荷時のデフォルトにリセットする	7~10
Cisco IMC パスワードをデフォルトにリセットする	6~11
CMOS のクリア	3~14
BIOS の回復	2~15
パスワードのクリア	1~16

クリアパスワードスイッチの使用(位置1-16)

このスイッチを使用すると、管理者パスワードをクリアできます。

- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** DIP スイッチブロック SW1 およびピン 1-16 のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ5** 位置1から DIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があり ます。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャットダウンしてスタンバイ電源モードにします。
- **ステップ9** サーバから AC 電源ケーブルを取り外し、すべての電源を取り外します。
- **ステップ10** サーバの上部カバーを外します。
- **ステップ11** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
 - (注) スイッチをデフォルトに戻さない場合、オープンポジションであり、サーバの電源を再投入す るたびにパスワードが消去されます。
- **ステップ12** サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ13 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- ステップ14 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

BIOS リカバリ スイッチの使用(位置 2 - 15)

どのステージで BIOS が破損しているかにより、さまざまな動作が発生することがあります。

•BIOS BootBlock が破損すると、システムが次のメッセージで停止する場合もあります。

Initializing and configuring memory/hardware

・ブートブロック以外が破損している場合は、次のようなメッセージが表示されます。

****BIOS FLASH IMAGE CORRUPTED**** Flash a valid BIOS capsule file using Cisco IMC WebGUI or CLI interface. IF Cisco IMC INTERFACE IS NOT AVAILABLE, FOLLOW THE STEPS MENTIONED BELOW. Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
 Reset the host.
 IF THESE STEPS DO NOT RECOVER THE BIOS
 Power off the system.
 Mount recovery jumper.
 Connect the USB stick with bios.cap file in root folder.
 Power on the system.
 Wait for a few seconds if already plugged in the USB stick.
 REFER TO SYSTEM MANUAL FOR ANY ISSUES.

(注) 上部に表示されるメッセージによって示されるように BIOS を回復するには、2 種類の方法が あります。まず、手順1を試行します。この手順で BIOS が回復しない場合は、手順2を使用 します。

手順1:recovery.cap ファイルを使った再起動

ステップ1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。

- **ステップ2**展開したリカバリフォルダ内のファイルを、USBドライブのルートディレクトリにコピーします。リカ バリフォルダにはこの手順に必要な bios.capファイルが含まれます。
 - (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システムでフォーマットする必要があります。
- ステップ3 USB ドライブをサーバの USB ポートに接続します。
- ステップ4 スタンバイ側の電源にサーバを再起動します。

サーバが、更新された BIOS ブートブロックでブートします。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファ イルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

- ステップ5 サーバの BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。
 - BIOS の更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約 10 分間空白になります。
 更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を 投入します。

手順2:BIOS リカバリ スイッチおよび bios.cap ファイルの使用

- ステップ1 BIOS 更新パッケージをダウンロードし、一時的な場所に保存して展開します。
- **ステップ2** 展開したリカバリフォルダ内のファイルを、USBドライブのルートディレクトリにコピーします。リカ バリフォルダにはこの手順に必要な bios.cap ファイルが含まれます。

- (注) bios.cap ファイルは、USB ドライブのルート ディレクトリにある必要があります。このファイ ルの名前を変更しないでください。USB ドライブは、FAT16 または FAT32 ファイル システム でフォーマットする必要があります。
- ステップ3 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ4** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ5** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ6** DIP スイッチブロック SW1 およびピン 2-15 のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ1** 位置2からDIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ8** ステップ2で準備した USB メモリをサーバの USB ポートに接続します。
- **ステップ9** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力に起動できるようにします。

変更を有効にするためにサーバを主な電力に戻す必要はありません。Cisco IMC (BMC)のみを再起動す る必要があります。Cisco IMC の起動が完了後、変更が適用されます。

Cisco IMCが更新された BIOS ブートブロックで起動します。BIOS が USB ドライブの有効な bios.cap ファ イルを検出すると、次のメッセージが表示されます。

Found a valid recovery file...Transferring to Cisco IMC System would flash the BIOS image now... System would restart with recovered image after a few seconds...

- **ステップ10** BIOS 更新が完了するのを待ってから、USB ドライブをサーバから取り外します。
 - (注) BIOSの更新中に、Cisco IMC はサーバをシャットダウンし、画面が約10分間空白になります。 更新中は、電源コードを外さないでください。更新が完了すると、Cisco IMC はサーバの電源を スタンバイに投入します。
- **ステップ11** サーバから完全に電力を取り外すには、もう一度のすべての電源ケーブルを取り外します。
- **ステップ12** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
 - (注) スイッチをデフォルトのオープン ポジションに戻さない場合、リカバリ完了後に「リカバリ ジャンパを取り外してください。」と表示されます。
- **ステップ13** サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ14** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします。
- **ステップ15** 電源ボタンを押してサーバのメイン電力の電源を完全にオンにします。

クリア CMOS スイッチの使用(位置 3-14)

このスイッチで、システムがハングアップしたときにサーバのCMOS設定をクリアできます。 たとえば、設定が正しくないためにサーバがハングアップしてブートしなくなった場合に、こ のジャンパを使って設定を無効化し、デフォルト設定を使って再起動できます。

- 注意 CMOSをクリアすることによってカスタマイズされた設定が削除されるため、データが失われ ることがあります。このCMOSのクリア手順を使用する前にBIOSに必要なカスタマイズされ た設定を書き留めます。
- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。
- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** DIP スイッチ ブロック SW1 およびピン 3 14 のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ5** 位置3から DIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。
- **ステップ7** 前面パネルの電源ボタンを押して、サーバを主電源モードに戻します。電源LEDが緑色になれば、サーバは主電源モードです。
 - (注) リセットを完了するには、サーバ全体が再起動して主電源モードになるようにする必要があり ます。ホスト CPU が実行されていないと、ジャンパの状態は判別できません。
- **ステップ8** 電源ボタンを押し、サーバをシャット ダウンしてスタンバイ電源モードにします。
- **ステップ9** サーバから AC 電源ケーブルを取り外し、すべての電源を取り外します。
- **ステップ10** サーバの上部カバーを外します。
- **ステップ11** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
 - (注) スイッチをデフォルトに戻さない場合、オープン ポジションになり、サーバの電源を再投入す るたびに CMOS 設定がデフォルトにリセットされます。
- **ステップ12** サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ13 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします。
- ステップ14 電源ボタンを押してサーバのメイン電力の電源を完全にオンにします。

デフォルトスイッチへの Cisco IMC パスワード デフォルト リセットの 使用(位置 6 ~ 11)

この Cisco IMC デバッグ スイッチを使用して、Cisco IMC パスワードを強制的にデフォルトに 戻すことができます。

- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** DIP スイッチ ブロック SW1 およびピン 6-11 のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ5** 位置6からDIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。

変更を有効にするためにサーバを主な電力に戻す必要はありません。Cisco IMC (BMC)のみを再起動す る必要があります。Cisco IMC の起動が完了後、変更が適用されます。

- (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。
 'Reset to default CIMC password' debug functionality is enabled.
 On input power cycle, CIMC password will be reset to defaults.
- (注) スイッチをデフォルトに移動しない場合、サーバの電源を入れ直すたびに Cisco IMC のがデフォ ルトにリセットされます。Cisco IMC を再起動する場合は、スイッチは影響を与えません。
- ステップ7 サーバから AC 電源ケーブルを取り外し、すべての電源を取り外します。
- **ステップ8** サーバの上部カバーを外します。
- **ステップ9** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
- **ステップ10** サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ11** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします。
- ステップ12 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

デフォルト スイッチへの Cisco IMC の使用(位置ピン7~10)

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC 設定を強制的にデフォルトに戻すことができます。

- ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。
- ステップ2 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネルからケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- ステップ3 サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** DIP スイッチ ブロック SW1 およびピン 7-10 のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ5** 位置 7 から DIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。

変更を有効にするためにサーバを主な電力に戻す必要はありません。Cisco IMC(BMC)のみを再起動す る必要があります。Cisco IMCの起動が完了後、変更が適用されます。

- (注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。
 'CIMC reset to factory defaults' debug functionality is enabled.
 On input power cycle, CIMC will be reset to factory defaults.
- (注) スイッチをデフォルトに移動しない場合、サーバの電源を入れ直すたびに Cisco IMC の設定が デフォルトにリセットされます。Cisco IMC を再起動する場合は、スイッチは影響を与えません。
- **ステップ7** サーバから AC 電源ケーブルを取り外し、すべての電源を取り外します。
- **ステップ8** サーバの上部カバーを外します。
- **ステップ9** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
- **ステップ10** サーバに上部カバーを戻します。
- ステップ11 すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします。
- ステップ12 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。

起動代理 Cisco IMC イメージスイッチ(位置ピン8~9)

この Cisco IMC デバッグ ヘッダーを使用して、Cisco IMC 代替イメージからシステムを強制的 に起動することができます。

ステップ1 サーバをシャットダウンして、電源を切ります(サーバのシャットダウンと電源切断 (8ページ)を参照)。すべての電源装置から電源コードを外します。

- **ステップ2** 上部カバーを取り外せるように、サーバをラックの前方に引き出します。場合によっては、背面パネル からケーブルを取り外して隙間を空ける必要があります。
 - **注意** コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからサーバを取り出して ください。
- **ステップ3** サーバ上部カバーの取り外し(11ページ)の説明に従ってサーバから上部カバーを取り外します。
- **ステップ4** DIP スイッチ ブロック SW1 およびピン 8-9のスイッチを検索します(図 51:シャーシのマザーボード 上の DIP スイッチの場所(115ページ)を参照してください)。
- **ステップ5** 位置 8 から DIP スイッチを閉じた位置に移動します。
- **ステップ6** 上部カバーと AC 電源コードをもう一度サーバに取り付けます。サーバの電源がスタンバイ電源モード になり、前面パネルの電源 LED がオレンジ色に点灯します。

変更を有効にするためにサーバを主な電力に戻す必要はありません。Cisco IMC (BMC)のみを再起動す る必要があります。Cisco IMC の起動が完了後、変更が適用されます。

(注) 次回 Cisco IMC にログインすると、次のようなメッセージが表示されます。

'Boot from alternate image' debug functionality is enabled. CIMC will boot from alternate image on next reboot or input power cycle.

- (注) スイッチをデフォルトに戻さない場合、オープンポジションとなり、サーバの電源を再投入するか、または Cisco IMC を再起動するたびに、Cisco IMC 代替イメージからサーバが起動します。
- **ステップ7** サーバから AC 電源ケーブルを取り外し、すべての電源を取り外します。
- **ステップ8** サーバの上部カバーを外します。
- **ステップ9** DIP スイッチをデフォルトのオフの位置に戻します。
- **ステップ10** サーバに上部カバーを戻します。
- **ステップ11** すべての電源に電源ケーブルを再接続し、サーバがスタンバイ電力モードに起動できるようにします(前面パネルの電源ボタンの LED がオレンジ色に点灯する場合に示される)。
- **ステップ12** 電源ボタンを押してサーバの電源を完全にオンにします。